CES 2026

혁신가들의 등장 – When Tech Steps Into Life

백길현, USCPA 반도체
02 3770 5635
gilhyun.baik@yuantakorea.com

고선영 전기전자
02 3770 3525
sunyoung.kou@yuantakorea.com

김용민 조선/자동차
02 3770 5606
yongmin.kim@yuantakorea.com

백종민 방산/AI/로보틱스
02 3770 5598
jongmin.baik@yuantakorea.com

유안타증권
Yuanta Securities (Korea)

CES 2026

백길현, USCPA

반도체

02 3770 5635
gilhyun.baik@yuantakorea.com

고선영

전기전자

02 3770 3525
sunyoung.kou@yuantakorea.com

김용민

조선/자동차

02 3770 5606
yongmin.kim@yuantakorea.com

백종민

방산/AI/로보틱스

02 3770 5598
jongmin.baik@yuantakorea.com

CONTENTS

Intro	Dive in에서 Show up으로	7
PART 1	제본스의 역설과 pSLC의 마법	27
PART 2	개인화의 시대 (feat. 전장)	38
PART 3	천일양병 일일용병	48
PART 4	꿈의 영역에서 상용화의 영역으로	57

SUMMARY

Intro. Dive in에서 Show up으로

CES 2025에서는 AI가 Agent 및 Physical AI로 구체화되며 초기 생태계에 진입한(Dive in) 해였다면 올해는 AI 기반 하나의 완결된 생태계를 형성해 산업 구분 없는 인프라 확장과 수익성을 동반한 신규 비즈니스 모델로 가시화되는(Show up) 해라고 평가한다. 총 6차례에 걸친 기조연설에서 얻을 수 있던 인사이트는 2가지로 : 1) AI 경쟁의 중심이 기존 반도체 성능 경쟁에서 플랫폼 주도권 확보 경쟁으로 이동했다는 것, 2) Physical AI가 제조업 내 적용 범위가 확대되면서 실질적인 생산 경쟁력 수단으로 진입했다는 점이다.

Part 1. [반도체] AI 인프라 시장 변화 속 제본스의 역설과 pSLC의 마법

CES 2026을 통해 확인된 AI 산업의 본질은 기술적 불확실성의 해소가 아닌, '시스템 경제학'에 기반한 확정적 성장 궤도로의 진입이다. 지난 5년 간의 실험적 투자가 시장의 외형을 키웠다면, 이제는 소수의 거대 플랫폼을 중심으로 인프라의 측정 단위가 ' 칩 ' 에서 ' 시스템(Rack) ' 과 ' 토큰(Token) 단가 ' 로 격상되었음을 재확인했다. NVIDIA는 루빈(Rubin) 아키텍처를 통해 추론 비용을 10배 절감하며 '제본스(Jevons Paradox)의 역설'을 현실화했다. 이는 비용 절감이 아닌 폭발적인 토큰 수요 증가로 이어지며, 고부가가치 AI SSD(pseudo SLC 모드 전환)와 랙 내부 정밀 액체 냉각(DLC) 부품으로의 부가가치 전이를 가속화 시킬 것으로 전망이다. 특히 TLC 제품을 pSLC 모드로 전환하여 사용하면 실제 저장 용량은 1/3 수준으로 줄어들기 때문에, 고객이 원하는 동일한 용량을 공급하기 위해서는 물리적인 웨이퍼 투입량을 3~4배 이상 늘려야만 하는 구조적 변화가 발생한다는 점을 주목한다. 당사 리서치센터는 글로벌 메모리반도체 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지한다. 관련하여 국내 삼성전자(005930 KS, 목표주가 17.2만원 유지, SK하이닉스(000660 KS, 목표주가 91.0만원으로 상향조정)을 제시한다. 한편 시장의 우려와 달리 냉각 및 스토리지 분야의 기술적 난도는 오히려 서버 내부로 심화되며 공급망 전반의 ASP 상승을 유도할 것이다. 관련하여 대만 AVC(Asia Vital Components, 3017 TT), 일본 Furukawa Electric(5715 JP)에 중장기 수혜가 집중될 전망이다. AMD는 엔비디아의 수직 계열화에 대응하여 개방형 표준(Helios, Ultra Ethernet) 기반의 요타스케일 컴퓨팅 비전을 구체화했다. 2026년을 ' 에이전트의 해'로 명명하며, 클라우드와 에지(Edge)를 잇는 End-to-end 솔루션을 통해 AI의 접근성과 경제적 장벽을 허무는 데 주력하고 있다.

Part 2. [전기전자] 개인화의 시대 (feat. 전장)

전기전자 투자 아이디어는 크게 2가지이다. 우선 1) AI 기반 개인화 전략. AI를 단일 기능이 아닌 B2C, B2B 대상 사용자 맥락을 이해하는 통합 솔루션으로 진화시키는 방향과 2) 가정과 제조업 현장에 한정되었던 AI 적용 범위를 모빌리티 및 전장 영역으로 확장하며 AI의 활동 반경을 고정된 공간에서 이동 가능한 환경으로 넓히려는 시도이다. 단기적인 관점에서는 실질적인 수요 확대가 진행 중인 전장 기반 B2B 개인화 전략에 주목할 필요가 있다고 판단하며 관련 종목으로 해성디에스(목표주가 NR, 중국 전기차 시장 성장이 이끌 견조한 리드프레임 수요), LG이노텍(목표주가 33만원 유지, LG 내 전장 포트폴리오 확장 움직임 → 센서 하드웨어+소프트웨어 결합으로 B2B 단에서의 개인화 전략 효과 가시화), 삼성전기(목표주가 33만원 유지, MLCC 응용처 변화가 만들어낼 수혜, 수요 중심이 기존 모바일에서 전장으로 이동 중)를 제시한다.

SUMMARY

Part 3. [자동차] 천일양병 일일용병

보스턴 다이내믹스 (BD)의 Atlas 공개를 필두로 CES 2026에서 자동차 업종은 로보틱스 신사업으로 인한 스포트라이트를 받았다. 자동차 업종이 로봇 관련 투자심리로 상승을 경험한 현 시점에서 필요한 질문은 "자동차 업종내 기업들이 로보틱스 사업 전개에서 유리한 것은 무엇인가?"이다. 현대차그룹을 비롯한 업종 내 주요 기업들은 이미 오래 전부터 로보틱스 기술력을 강화하고 있었으며, 금번 CES를 통해 이를 입증. 향후 BD의 기업공개와 non-captive향 수주 발생시 업종내 로보틱스 관련 긍정적 투자심리는 유효할 것이라 예상한다.

Part 4. [AI/로보틱스] 꿈의 영역에서 상용화의 영역으로

이번 CES2026에서 최대 화두는 단연코 로봇과 Physical AI 분야였다. 불과 1년 전만해도 개념의 영역이었던 Physical AI 분야가 상용화 단계로 진입한 모습이 나타났다. AI가 로봇 등의 기기와 결합되며, 올해 상반기에 출시 가능한 수준의 기술을 시연했다고 평가되었다. 이는 관련 기술이 산업과 일상 생활을 변화시키는 Physical AI 시대가 도래했음을 의미한다. 특히 휴머노이드에 대한 관심도가 높았다. 한국에서는 현대차그룹의 보스턴다이내믹스와 LG전자가 휴머노이드를 공개했으며, 중국의 선두 업체 유니트리, AGIBOT 등은 구체적인 비즈니스 모델을 제시했다. 그러나 기술적 한계도 명확한 모습이다. 현재 휴머노이드의 기술 수준은 상용화를 통한 ROI를 논하기보다, 차세대 버전을 위한 현장 데이터 확보 목적에 가까운 것으로 보인다. 그럼에도, AI Agent, 로봇 손 등 주요 세부 기술들의 발전 속도와 국가적 역량이 투입되는 산업인 점을 고려하면 상용화 시기가 앞당겨질 가능성이 존재한다. 휴머노이드 만큼 로봇 손에 대한 주목도가 높았다. 휴머노이드 완제품 시장 내 승자가 정해지지 않았고, 휴머노이드 양산의 기술적 병목으로 로봇 손이 꼽히고 있기 때문이다. 한국의 **로보티즈, 원익로보틱스** 등이 이번 CES2026에서 로봇 손 업체로 주목을 받았던 것으로 파악된다. 이 밖에도 **두산로보틱스, 에스비비테크, 마음AI** 등이 이번 전시에서 두각을 나타냈다. 휴머노이드에 대한 갑론을박이 여전한 지금, 당장 상용화 가능한 Physical AI 기술을 시연한 상기 기업들을 주목할 필요가 있다고 판단된다.

고선영

전기전자

02 3770 3525

sunyoung.kou@yuantakorea.com

Intro

Dive in에서 Show up으로

CES 2026 혁신가들의 등장, 'When Tech Steps Into Life'

- CES(Consumer Electronics Show)는 글로벌 최대 규모의 소비자 기술 전시회로 매년 주요 기조연설을 통해 중장기 산업 발전 방향과 핵심 기술 트렌드를 제시한다. 전시 기간 동안 참여 기업들은 글로벌 투자자와 산업 관계자를 대상으로 기술 혁신에 대응하기 위한 전략적 로드맵과 사업 방향성을 구체화한다.
- 지난해 CES 2025는 'Connect. Solve. Discover. DIVE IN'을 슬로건으로 AI 적용 기술 확산의 초기 국면을 강조했다. 그런데 올해 CES 2026은 'Innovators Show Up'이라는 메시지 아래 그 이후 실행한 기술들에 대한 실질적인 성과와 실행력에 초점을 맞춘 모습이다. 핵심 기술은 '24~25년과 마찬가지로 AI가 최우선으로 제시되었으며 로보틱스, 모빌리티, 디지털 헬스가 주요 테마로 함께 자리했다.
- '25년이 AI가 Agent 및 Physical AI 형태로 구체화되며 초기 생태계에 진입한 해(Dive in)였다면 '26년은 AI가 하나의 완결된 생태계를 형성해 산업 구분 없는 인프라로 확장되고 수익성을 동반한 신규 비즈니스 모델로 가시화되는 해(Show up)라고 판단한다. 이는 AI가 기술 시연 단계를 넘어 실제 산업 적용과 투자 회수 국면으로 진입하고 있음을 시사한다.

CES 2026 주 무대가 된 LVCC 센터. 그 중 로보틱스 관련 기업들의 집중도가 높았던 West Hall

자료: CES 2026, 유안타증권 리서치센터

CES 2025 vs CES 2026. 슬로건에서 확인되는 AI를 바라보는 시기별 시선 차이

	CES 2025	CES 2026
슬로건	**Connect. Solve Discover. DIVE IN 기술을 통해 연결되고 문제를 해결하며, 발견하는 '몰입'**	**Innovators Show Up 혁신가들의 등장**
기술 테마	AI, 로보틱스, 모빌리티, 스마트홈, 전력, 에너지	AI, 로보틱스, 모빌리티, 스마트홈, 디지털헬스, 생산성 향상
특징	일상으로 진출, Agent AI, Physical AI 본격적으로 선보임	AI, 블록체인, 양자기술 등 산업 구분 없는 종합 인프라 구축

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

연설을 통해 얻은 2가지 Insight : 1) AI 플랫폼 주도력

- 총 6차례에 걸쳐 진행된 기조연설을 통해 개별 기업이 AI를 인식하는 프레임 자체가 과거 대비 뚜렷하게 전환되고 있음을 확인할 수 있었다. 과거 2년이 Generative AI, Agent AI를 중심으로 한 개념 정립의 단계였다면 CES 2026에서는 로보틱스, 자율주행 등 물리적 실체를 동반한 Physical AI로 시장의 관심이 이동하는 모습이 두드러졌다. 물론 AI 적용 속도와 방식은 산업 및 기업별로 차별화되어 있으나 이미 다양한 산업에서 실증적 시도가 병행되고 있다는 점은 공통적으로 확인된다.
- 산업 간 경계는 점차 희석되고 있으며 개인화라는 삶과 보다 밀접한 영역을 중심으로 AI 확산 속도는 가속화되고 있다. **이번 CES 2026 기조연설들을 통해 얻을 수 있었던 인사이트는 크게 두 가지이다. 1) AI 경쟁의 중심이 기존 반도체 성능 경쟁에서 플랫폼 주도권 확보 경쟁으로 이동하고 있다는 점, 2) Physical AI가 제조업에서 실질적인 생산 경쟁력의 수단으로 진입하고 있다는 점이다.**
- 우선 NVIDIA와 AMD의 기조연설에서 확인되듯이 **현재 AI 경쟁의 무게중심은 단일 반도체 성능을 넘어 AI 가속기-소프트웨어-네트워크를 포괄하는 플랫폼 주도권으로 이동하고 있다.** 양사는 신제품 공개와 함께 하드웨어 성능 자체보다 생태계 통합 능력과 확장성을 핵심 메시지로 강조했다, 이는 AI를 개별 제품이 아닌 범용 인프라로 정의하려는 전략적 움직임이라고 판단한다.

특별연설과 기조연설 : AI 플랫폼 기반의 패권 경쟁 – NVIDIA vs AMD

<NVIDIA CES 2026 특별연설 (26.1.5)>

Now on top of this platform, NVIDIA is a frontier AI model builder, and we build it in a very special way. We build it completely in the open so that we can enable every company, every industry, every country, to be part of this AI revolution

△ NVIDIA는 기존 플랫폼 위에 프론티어 AI 모델 개발자로서의 역할을 병행하고 있다. **해당 모델은 완전한 오픈 구조로 설계되고 있으며 이는 모든 기업/산업/국가가 AI 생태계에 참여할 수 있게 하여 AI 확산을 가속화하려는 전략이다.**

<AMD CES 2026 기조연설 (26.1.5)>

And to keep up with this compute demand, you really need the entire ecosystem to come together. It starts with leadership compute, CPUs, GPUs, networking coming together. It takes an open modular rack design that can evolve over product generations. It requires high-speed networking to connect thousands of accelerators into a single unified system. And it has to be really easy to deploy.

△ 급증하는 연산 수요에 대응하기 위해서는 **단일 기술이 아닌 전체 생태계의 유기적 결집이 필수적**이다. CPU, GPU, 네트워킹이 통합된 연산 스택에서 출발하며, 제품 세대에 따라 진화 가능한 오픈 모듈형 랙 설계가 전제되어야 한다. 또한 수천 개의 가속기를 단일 시스템으로 연결할 수 있는 초고속 네트워크 인프라가 요구되며, 고객 환경에서 신속하고 용이한 배포가 가능해야 한다.

자료: CES 2026, 유안타증권 리서치센터

NVIDIA – AI Scales Beyond LLMs

자료: NVIDIA(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

엔비디아 vs AMD, 신제품 공개와 함께 강조한 플랫폼화와 협력 체제

- AI 경쟁은 개별 기술 우위 경쟁에서 기술 스택 전반의 통합 경쟁으로 이동하고 있다고 판단한다. 과거에는 AI 모델 개발 역량이 경쟁의 중심이었다면 현재는 AI 서버용 칩, 대규모 트레이닝 클러스터, 클라우드 제공 능력, API 생태계, 그리고 최종 사용자와의 연결성까지 얼마나 넓고 깊게 통제할 수 있는지가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 특히 신규 경쟁 영역의 확대는 빅테크 기업들이 기존 핵심 사업을 넘어 AI를 매개로 인접 기술 스택으로 빠르게 확장하고 있음을 의미한다.
- **그 중 NVIDIA는 AI 스택 전반을 가장 선제적으로 통합한 기업으로 평가해볼 수 있다.** 동사는 AI 서버용 GPU를 출발점으로 트레이닝 클러스터, 네트워킹, 소프트웨어, 개발자 API에 이르기까지 수직적으로 영역을 확장했으며 최근에는 자율주행 및 로보틱스로 포트폴리오를 넓히며 AI 인프라의 사실상 표준 지위를 공고히 하고 있다.
- 반면 이번 AMD 기조연설에 함께한 **OpenAI는 LLM과 API 중심의 소프트웨어 스택에서 출발해 최근에는 트레이닝 및 디바이스 영역으로 영향력을 확대**하고 있다. CES 2026에서 강조된 AMD와의 협력은 **장기적으로 AI 연산 시장을 NVIDIA 중심의 단일 표준 구조에서 다중 아키텍처가 공존하는 경쟁 구도로 전환하려는 전략적 시도**로 해석된다. 이는 향후 AI 인프라 시장 내 플랫폼 주도권 경쟁이 보다 구조적으로 심화될 가능성을 시사한다.

북미 빅테크들의 AI 스탯 발전 NVIDIA vs AMD+OpenAI

	AI 서버칩	AI 트레이닝 클러스터	클라우드 AI 서버	AI 맵 API	최신형 LLM	엔터프라이즈 AI 앱	컨슈머 AI 앱	웨어러블 AI 장치	휴머노이드 및 로보틱스
Google	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Microsoft	○	○	○	○	○	○	○		
Amazon	○	○	○	○	○	○	○		○
OpenAI	○	○		○	○	○			○
Meta	○	○		○	○		○	○	○
Tesla	○	○		○	○		○		○
NVIDIA	○	○	○	○	○				○
Apple	○	○			○		○	○	○
Anthropic		○		○	○	○			

자료: 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

연설을 통해 얻은 2가지 Insight : 2) 제조업과 Physical AI

- **두 번째 인사이트는 Physical AI가 제조업 현장 내 적용 범위가 본격적으로 확대되고 있다는 점이다.** Siemens와 Caterpillar의 기조연설을 통해 확인되었듯이 독일과 미국을 대표하는 제조 기업들의 AI 적용 전략 변화는 AI가 더 이상 보조 역할에 머무르지 않고 현장의 기계, 설비, 공정 전반에 직접 개입하는 단계로 진화하고 있음을 시사한다. Physical AI는 단순 자동화를 넘어 스스로 인지, 판단 및 제어하는 기술로서 제조, 에너지, 인프라 등 산업 구분 없는 확장 가능성을 드러내고 있다. 이는 현재 **글로벌 공급망 재편 국면에서 생산력과 제조 경쟁력을 동시에 확보하려는 전략적 대응**으로 해석할 수 있다.
- 구체적으로 Siemens는 AI가 제품 설계와 제조 방식을 근본적으로 재정의했으며 제조 공정 자체가 하나의 거대한 로봇 시스템으로 진화할 것이라고 전망했다. Caterpillar 역시 디지털 경제는 궁극적으로 물리적 자산 위에 구축될 수밖에 없으며 이로 인해 중장비 산업이 전통적인 제조업을 넘어 지능형 산업으로 전환되고 있다고 강조했다. 결론적으로 이번 CES에서 **전통적인 인프라 기업들이 공통적으로 AI와 결합된 제조 전략을 전면에 내세운 점은 AI가 실물 자산과 결합해 기업 경쟁력을 넘어 국가 단위의 산업 경쟁력으로 전환되는 구조적 변화의 출발점으로 평가**한다.

기조연설 : 제조업 내 적용 범위가 확대된 Physical AI – Siemens & Caterpillar

<Siemens CES 2026 기조연설 (26.1.6)>

Artificial Intelligence will be as transformative for this century as electricity was for the last. It's redefining how we design and manufacture products. The entire factory is going to be one giant robot. It's going to orchestrate a whole bunch of robots that themselves are robotic, and they're going to make products like cars that are software defined in robots.

△ 인공지능은 지난 세기 전기가 수행했던 역할에 필적할 만큼, 이번 세기의 산업 구조를 근본적으로 변화시킬 기술이다. **AI는 제품의 설계와 제조 방식을 재정의하고 있으며, 향후 제조 공장은 하나의 거대한 로봇 시스템으로 진화할 전망**이다. 해당 공장은 다수의 로봇을 통합적으로 제어하며, 자동차와 같은 제품 역시 로봇 기반 공정 위에서 생산되는 구조로 전환될 것으로 예상된다.

<Caterpillar CES 2026 기조연설 (26.1.7)>

The digital world depends on a physical layer most people never think about. Caterpillar is here because they are redefining what heavy industry looks like in the age of data, autonomy, and AI.

△ 디지털 경제는 단순한 소프트웨어 위에 존재하는 것이 아니라 물리적 레이어 위에 구축된다. Caterpillar가 이번 CES에 등장한 이유는, **중장비 산업이 더 이상 전통적 제조에 머무르지 않고 데이터, 자율주행, AI를 결합한 지능형 산업 인프라로 재정의**되고 있음을 보여주기 위함이다.

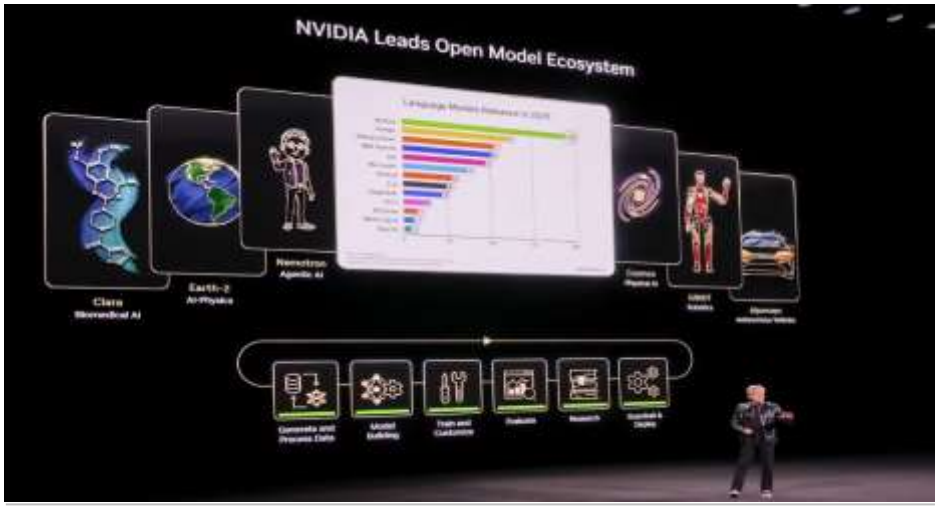
자료: Siemens(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Siemens – AI 기반 적응형 제조 (Adaptive Manufacturing) with NVIDIA

자료: Siemens(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

CES 기조연설을 담당한 대표 기업들의 핵심 메시지 및 제품

1) NVIDIA의 Open Models for All



자료: NVIDIA(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

2) AMD의 Open Ecosystem Drives AI Innovation

자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

3) Siemens의 AI-native Adaptive Manufacturing (feat. NVIDIA)

자료: Siemens(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

4) Caterpillar의 CAT AI ASSISTANT

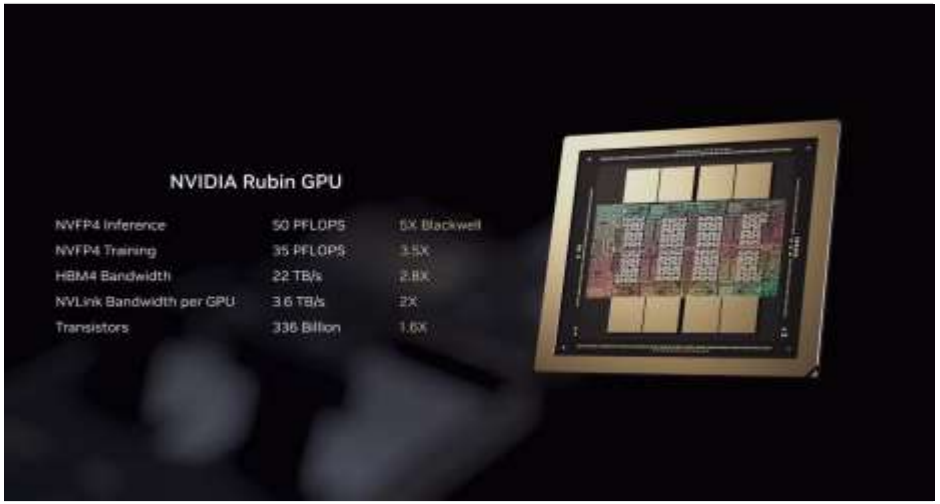
자료: Caterpillar(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

1) 엔비디아 – 높은 컴퓨팅 수요와 GPU 신제품, 로보택시로의 확장

NVIDIA – AI 기반 컴퓨팅 수요

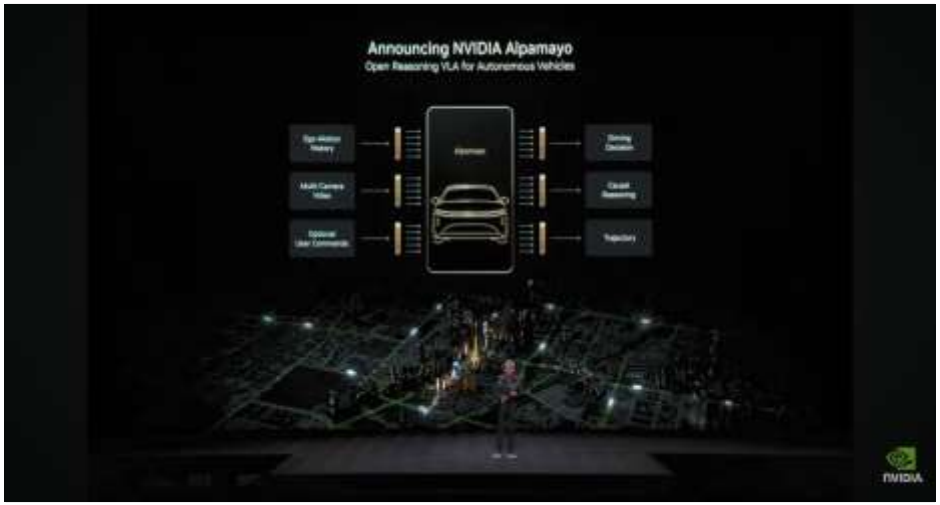
자료: NVIDIA(CES 2026),유안타증권 리서치센터

NVIDIA – 루빈 GPU 세부 스팩



자료: NVIDIA(CES 2026),유안타증권 리서치센터

NVIDIA – 자율주행 Alpamayo 1Q 미국 출시 시작



자료: NVIDIA(CES 2026),유안타증권 리서치센터

NVIDIA – 로보택시 생태계

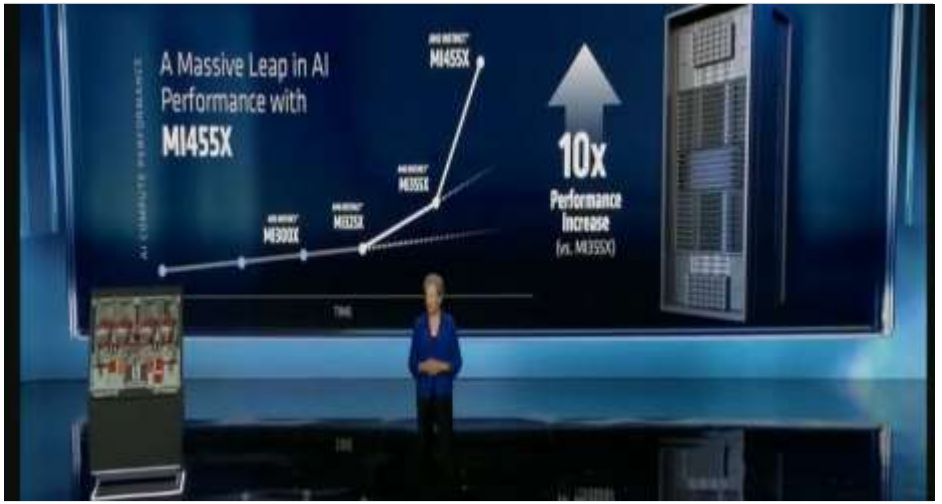
자료: NVIDIA(CES 2026),유안타증권 리서치센터

2) AMD – AI is Everywhere, 서버 대응 목적의 신제품, OpenAI와의 협력

AMD – AI 오픈랙 "Helios"

자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

AMD – MI455X



자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

AMD – 데이터센터 포트폴리오

자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

AMD – OpenAI와의 협력

자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

3) Siemens – 강조된 Xccelerator, 제조업 내 로봇과의 연결성 확보

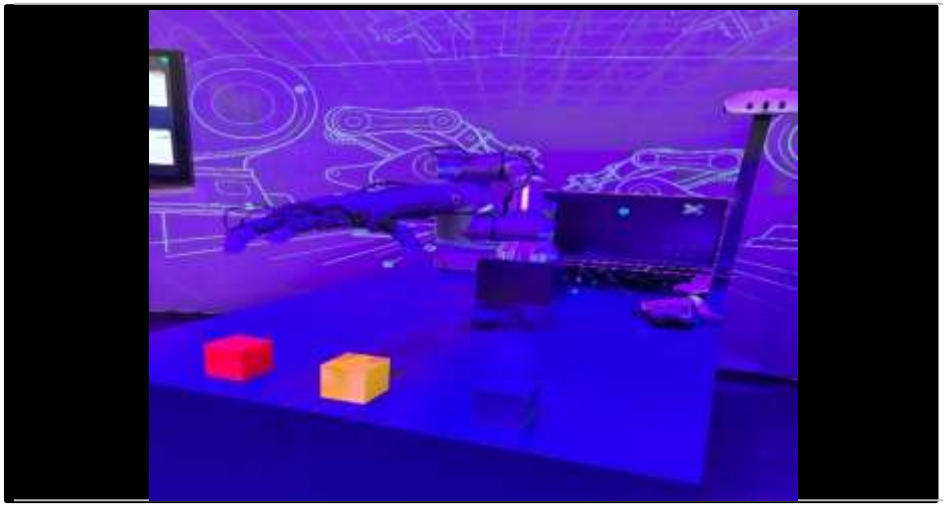
Siemens – CES 부스 현장 ①

자료: Siemens(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Siemens – CES 부스 현장 ②

자료: Siemens(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Siemens – xcelerator 적용 및 활용성 ①



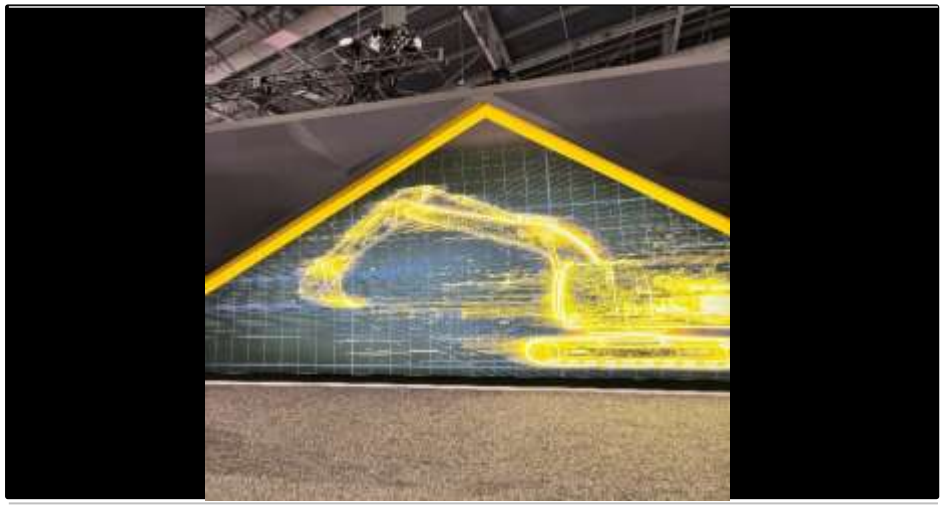
자료: Siemens(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Siemens – xcelerator 적용 및 활용성 ②

자료: Siemens(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

4) Caterpillar – 기존 제조 장비에 더해 AI 기술 접목된 Assistant

Caterpillar CES 부스 현장



자료: Caterpillar(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Caterpillar – 주요 전시 제품

자료: Caterpillar(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Caterpillar – AI 접목 기술 'CAT AI ASSISTANT' ①

자료: Caterpillar(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Caterpillar – AI 접목 기술 'CAT AI ASSISTANT' ②

자료: Caterpillar(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

+) John Deere – 제조업 외 농업에서도 확인된 AI 접목 생산 효율화 전략

John Deere CES 부스 현장

자료: John Deere(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

John Deere 주요 전시 제품 ①

자료: John Deere(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

John Deere 주요 전시 제품 ②

자료: John Deere(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

John Deere Operations Center Mobile

자료: John Deere(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (1)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
1	Video Display	Hisense	미국	163MX		마이크로LED 기반 초대형 디스플레이
2	Artificial intelligence Robotics	Doosan Robotics / Maple Advanced Robotics Inc.	대한민국	AI-powered Autonomous Mobile Robot Solution (Scan&Go)		비전과 물리 기반 AI 자율 이동 로봇 솔루션
3	Enterprise Tech	Sixfab	캐나다	ALPON X5 AI Edge Computer		Pi CM5, DEEPX NPU 기반 AI 엣지 컴퓨터
4	Sustainability & Energy Transition	Ampirus Technologies	미국	Ampirus 520 Wh/kg cell		차세대 고에너지 배터리
5	Drones	Yingling	중국	Antigravity A1		A1은 듀얼 렌즈 기반 8K 360 촬영이 가능한 차세대 드론

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (2)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
6	Pet & Animal Tech	Netvue Technologies	중국	Birdfy Bath Pro		태양광, 분수, 동절기 제빙, 안전 퍼치와 듀얼 렌즈 AI 종 인식 카메라를 탑재한 AI 기반 버드배스
7	Supply & Logistics Construction & Industrial Tech	Creative 3D Technologies	미국	C3DT EVO		금속, 플라스틱, 복합소재 적층 제조부터 밀링, 레이저, 반도체 공정까지 하나의 모듈형 장비로 통합한 싱글셀 제조 플랫폼
8	Digital Health	Earflo	호주	Earflo		삼출성 중이염을 치료하는 소아용 의료기기
9	Fintech	Crosshub	대한민국	Financial Passport by IDBlock and B·Pay		영지식증명 기반 여권 인증(IDBlock)과 국경 없는 결제(B·Pay)통합 핀테크 솔루션
10	Computer Hardware & Components	MSI Computer Corp	대만	GeForce RTX™ 5080 16G EXPERT Series		다이캐스트 알루미늄 바디와 Push-Pull 구조의 Flow Frozr 2 냉각 설계기반 그래픽카드

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (3)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
11	XR & Spatial Computing	STUDIO LAB	대한민국	Gency Studio		AI, 로봇, XR을 결합해 오프라인 매장을 실시간 콘텐츠 제작이 가능한 몰입형 브랜드 쇼룸으로 전환하는 체험형 리테일 솔루션
12	Enterprise Tech	HP Inc.	미국	HP EliteDesk 8 Mini G1a Desktop Next Gen AI PC		온디바이스 AI 성능과 엔터프라이즈급 보안, 관리 기능을 결합한 차세대 업무용 AI 데스크톱
13	Smart Communities	DummDumm Inc.	대한민국	Hydro Hawk – 5G Smart Water Sampling Drone System		5G 기반 드론으로 수질을 채수 및 분석해 실시간 데이터로 제공하는 스마트 수자원 관리 솔루션
14	In-Vehicle Entertainment	LG Electronics	대한민국	LG AI-powered In-Vehicle Solutions		온디바이스 AI 기반 인포테인먼트 솔루션
15	Imaging	LG Electronics	대한민국	LG SIGNATURE OLED TV		투명 OLED와 무선 박스를 통해 공간과 자연스럽게 융합되는 투명 TV

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (4)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
16	Smart Home	Lockin Technology (Beijing)	중국	Lockin AI Smart lock		정맥 인식과 온디바이스 AI 기반 스마트 도어락
17	Travel & Tourism	LBS Tech	대한민국	MaaS-Bridge: Accessible MaaS(Mobility-as-a-Service) Connectivity		AI로 교통, 보행 인프라와 사용자 특성을 분석해 차량 승하차 거점을 설계하는 통합 모빌리티 연결 솔루션
18	Robotics Vehicle Tech & Advaned Mobility	Lyte AI, Inc.	미국	LyteVision		4D 센싱과 RGB 비전, 모션 인지를 단일 플랫폼으로 통합한 센싱 솔루션
19	Robotics	Hyundai Motor Company	대한민국	MobED		불균형 지형에서도 안정 주행이 가능한 독립 구동 휠과 자율주행 기술을 갖춘 모듈형 모바일 로봇 플랫폼
20	Accessibility & Longevity	Naqi Logix Inc.	캐나다	Naqi Neural Earbuds with Invisible User Interface		미세한 얼굴 근육 움직임을 AI로 인식해 음성, 터치 없이 디지털 기기를 제어하는 비침습형 신경 인터페이스 이어버드

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

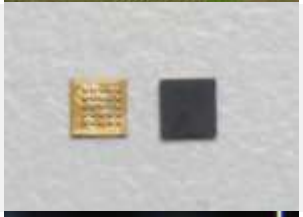
CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (5)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
21	Mobile Devices, Accessories & Apps	MANGOSLAB	대한민국	Nemonic Dot		모바일 앱과 휴대용 점자 프린터를 결합해 고품질 점자 라벨을 생성할 수 있게 하는 통합 점자 솔루션
22	Content & Entertainment	Nation A	대한민국	Neuroid Playmaker		텍스트, 음성, 영상 입력을 실시간으로 제작 가능한 3D 모션으로 변환하는 AI 기반 애니메이션 플랫폼
23	Sports & Fitness	Orphe Inc.	일본	Orphe Insole		압력, 모션 센서를 내장해 일상 착용만으로 보행과 움직임을 정밀 분석하는 초슬림 스마트 인솔
24	Robotics	Oshkosh Corporation	미국	Oshkosh JLG Boom Lift with Robotic End Effector		고소 작업 장비에 로봇 팔과 AI를 결합해 용접, 검사, 설치 등을 자율 수행하는 산업용 작업 로봇 플랫폼
25	Travel & Tourism	Oshkosh Corporation	미국	Oshkosh Striker Volterra Electric Airport Rescue and Firefighting Vehicle		배터리 전기와 디젤을 결합해 공항 내 무공해 주행과 초고속 출동을 구현한 전기 공항 소방, 구조 차량

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (6)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
26	Headphones & Personal Audio	Geeks Loft Inc.	대한민국	Perisphere: Audio Meets Vision		고음질 오디오에 디스플레이, 카메라, 마이크를 결합해 착용만으로 보고, 기록, 공유까지 가능한 헤드폰형 미디어 허브
27	Aritificial Intelligence	Deep Fusion AI	대한민국	RAPA (Real-time Attention-based Pillar Architecture for 4D Radar Perception)		4D 이미징 레이더 전용 AI로 실시간, 고정밀 객체 인식과 추적을 구현하는 레이더 기반 360° 인지 소프트웨어
28	Food Tech	BIENESIS SAS	프랑스	Robotic Canopy BIENESIS		AI와 로봇 팔로 기후 위험 시 자동 전개돼 고부가 작물을 보호하는 태양광 기반 스마트 농업 보호 시스템
29	Cybersecurity Embedded Technologies	Samsung Electronics America, Inc.	대한민국	S3SSE2A		양자내성암호(PQC)를 내장한 차세대 임베디드 보안 칩
30	Embedded Technologies	Samsung Electronics	대한민국	Samsung Micro RGB TV		독립 제어되는 마이크로 RGB 백라이트와 AI 화질 기술로 BT.2020 100% 색역과 초정밀 명암을 구현한 프리미엄 TV

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (7)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
31	Gaming & Esports Computer Peripherals & Accessories	Samsung Electronics America, Inc.	대한민국	Samsung Odyssey G60H		HD 해상도에서 600Hz(HD 기준 최대 1,000Hz)를 구현해 초고속, 초저지연 플레이를 제공하는 하이엔드 e스포츠용 게이밍 모니터
32	Beauty Tech	Kolmar Korea	대한민국	SCAR: AI-Powered Precision Scar Treatment and Coverage System Device		AI 피부 분석과 초정밀 마이크로 디스펜싱을 결합해 흉터 치료와 커버를 개인 맞춤으로 구현하는 지능형 뷰티 디바이스
33	Construction & Industrial Tech	SAMSUNG SDI	대한민국	SDI 25U-Power		18650 규격에서 최고 출력과 초고속 충전을 동시에 구현한 고출력 원통형 배터리
34	Products in Support of Human Security for All	Widemount Dynamics Tech Limited	홍콩	Smart Firefighting Robot		연기·무시야 환경에서도 자율 주행하며 화재를 인식·판단 및 진압하는 AI 기반 무인 소방 로봇
35	Fashion Tech	Qualcomm Technologies, Inc.	미국	Snapdragon W5+ Gen 2/ W5 Gen 2 Wearable Platforms		위성 SOS 통신과 저전력 및 고정밀 위치 인식을 지원하는 차세대 웨어러블 전용 SoC 플랫폼

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (8)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
36	Filmmaking & Distribution, in partnership with Cannes Next	Artnova Co., Ltd. and NEXTEP studio Co., Ltd., Gachon University, DAMGARA Co., Ltd.	대한민국	STORYSYNC: A Real-Time Interactive Media Facade of Mythic Stories		방문객의 SNS 이미지를 AI로 실시간 분석해 제주 신화를 기반한 미디어 파사드 콘텐츠로 변환하는 인터랙티브 문화 관광 플랫폼
37	Vehicle Tech & Advanced Mobility Accessibility & Longevity	Strutt Pte. Ltd.	싱가폴	Strutt ev¹		LiDAR, AI 기반 코파일럿으로 충돌을 예방하고 지형에 따라 주행을 보정하는 지능형 개인 모빌리티
38	Embedded Technologies	xMEMS Labs, Inc.	미국	Sycamore-N 1mm Thin Full-Range MEMS Micro Speaker for Smart Glasses		스마트 글래스를 위해 초박형, 초경량으로 설계된 고음질 풀레인지 MEMS 마이크로 스피커
39	EdTech	tonies	미국	tonies® Toniebox 2		스크린 없이 캐릭터를 통해 이야기, 음악, 놀이를 즐기며 아이의 자율성과 성장을 돕는 어린이용 오디오 플레이어
40	Home Appliances	Hisense	미국	X-Zone Master		메인 대용량 드럼에 미니 더블드럼 모듈을 자유롭게 확장 및 배치하는 확장형 세탁건조 플랫폼

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

Appendix - 최고 혁신상 수상작들

CES 2026 최고혁신상 수상작 리스트 (9)

NO.	수상 부문	기업명	국가	제품명	제품사진	제품 설명
41	Computer Hardware & Components	ADATA Technology Co., Ltd.	대만	XPG INFINITY RGB DDR5 Memory		최대 8000MHz의 초고속 성능과 재활용 알루미늄·PCR 플라스틱을 적용한 차세대 고성능 메모리 모듈
42	Computer Peripherals & Accessories	Zettlab Innovation Technology Co., Ltd.	중국	Zettlab AI NAS		온디바이스·오프라인 AI로 자연어 기반 멀티모달 검색과 지식 질의응답을 제공하는 차세대 스마트 NAS
43	Artificial Intelligence	CT5 INC.	대한민국	Zone HSS1		온디바이스 처리 기반의 웨어러블 AI 인터페이스

자료: CES, 유안타증권 리서치센터

백길현, USCPA

반도체

02 3770 5635
gilhyun.baik@yuantakorea.com

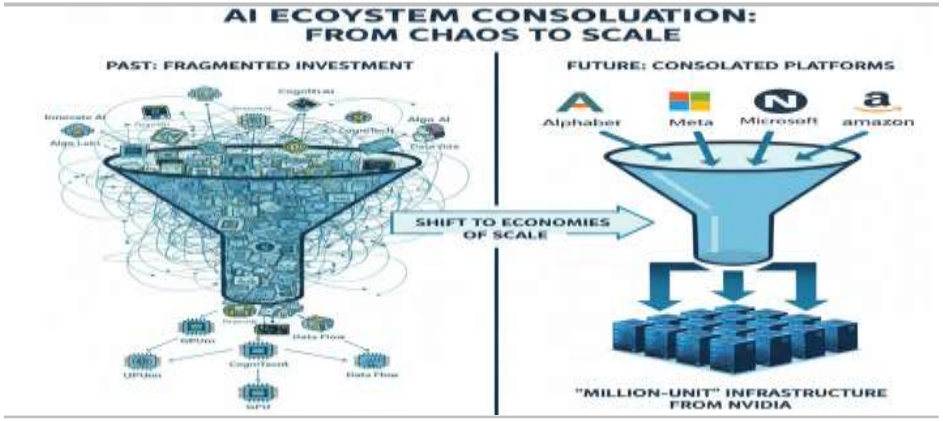
PART 1

제본스의 역설과 pSLC의 마법

AI 시장의 Consolidation → 'Q' 성장 본격화와 시스템 경제학의 시대

- AI 산업은 이제 '불확실한 기술 경쟁'을 넘어, 소수의 승자가 인프라를 독점하고 실질적인 수익(ROI)을 찍어내는 '확정된 성장의 시대'로 진입했다. 지난 5년간 수많은 스타트업의 중복 투자가 시장의 외형을 키웠다면, 이제는 거대 플랫폼(채널) 중심으로 시장이 통합(Consolidation)되면서 인프라의 측정 단위 자체가 '칩(Chip)'에서 '랙(Rack)', 그리고 최종적으로는 '토큰 생성 단가(Token Economics)'로 격상되는 중이다. 이러한 변화는 하드웨어 출하량(Q)의 단순 증가를 넘어, 인프라의 질적·양적 폭발을 야기할 전망이다.
- 첫째, 성능 상향 평준화 시대의 승부처는 **'제본스의 역설(Jevons Paradox)'에 기반한 비용 효율**이다. NVIDIA의 새로운 Rubin 아키텍처는 단순 성능 향상을 넘어, 블랙웰 대비 추론 비용을 10배나 절감하며 '토큰 이코노믹스'를 완성했다. 경제학의 ' 제본스의 역설 ' 처럼, 토큰 생성 단가가 파격적으로 낮아지면 기업들은 비용을 아끼는 것이 아니라 오히려 더 복잡하고 방대한 AI 워크로드를 가동하며 전체 소비량을 늘린다. 이러한 효율 개선은 Anthropic 같은 모델사들에게 더 넓은 수익 구간을 제공하며, 결과적으로 구형 인프라를 루빈 시스템으로 강제 교체하게 만드는 **거대한 교체 수요(Q)를 창출할 것으로 예상**한다.
- 둘째, ' 칩 ' 이 아닌 ' 랙(Rack) ' 단위의 확정 주문이 시장의 성격을 바꾼다. NVIDIA가 직접 클라우드 사업(DGX Cloud)을 축소하겠다고 선언한 것은, 이제 빅테크(CSP)들이 수십조 원 단위의 물량을 '랙 단위 시스템'으로 직접 받고 있기 때문이다. 랙 하나에 72개의 GPU와 CPU, 초고속 네트워킹(NVLink)이 결합된 통합 시스템으로 주문 단위가 격상되면서, 개별 고객의 수요는 '백만 단위'로 확장된다. 이는 공급망 전반에 걸쳐 예측 가능성을 높이고, 대규모 양산(Ramp-up)을 통한 규모의 경제를 가속화할 것으로 예상한다.
- 셋째, **'수익형 AI'의 등장이 인프라 투자에 대한 정당성(ROI)을 부여**한다. 단순 챗봇을 넘어 코딩 에이전트, 자율주행, 휴머노이드 로봇 등 '피지컬 AI'가 실질적인 매출을 내기 시작하면서, 기업들의 투자는 더 이상 실험적이지 않다. 시스템 레벨에서 처리량이 10배 이상 늘어나면 새로운 서비스 모델이 가능해지고, 이는 다시 15배 이상의 수요 증가로 이어지는 선순환(Flywheel) 구조를 만들 전망이다. 결국 네트워킹과 소프트웨어까지 한 몸으로 작동하는 NVIDIA의 ' AI 팩토리 ' 시스템은 기업들에게 가장 확실한 수익 창출 도구로 자리잡을 것이다.

그림. AI 산업, 주요 거대 플랫폼 중심으로의 Consolidation 진행



자료: 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

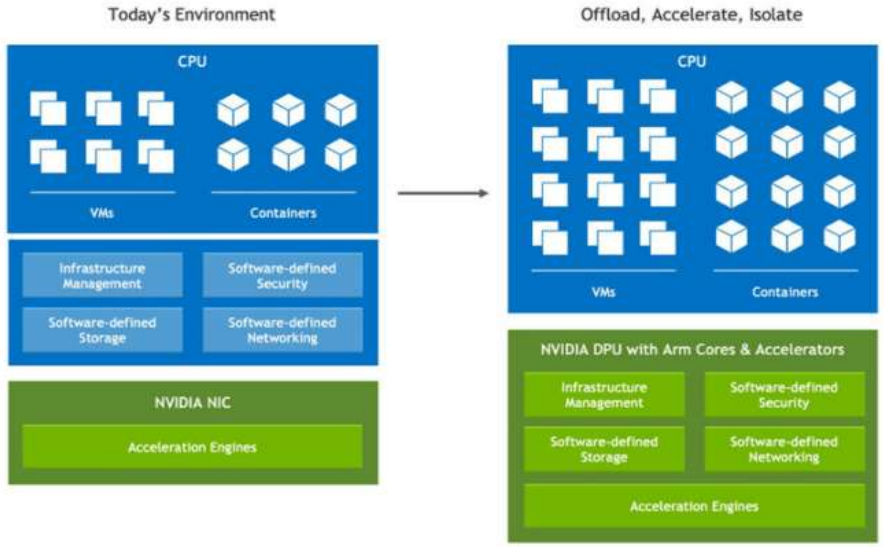
그림. NVIDIA at CES 2026, 랙 단위의 경제성을 강조

자료: NVIDIA(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

[NVIDIA Keynote] BlueField-4 DPU와 Next Storage 주목

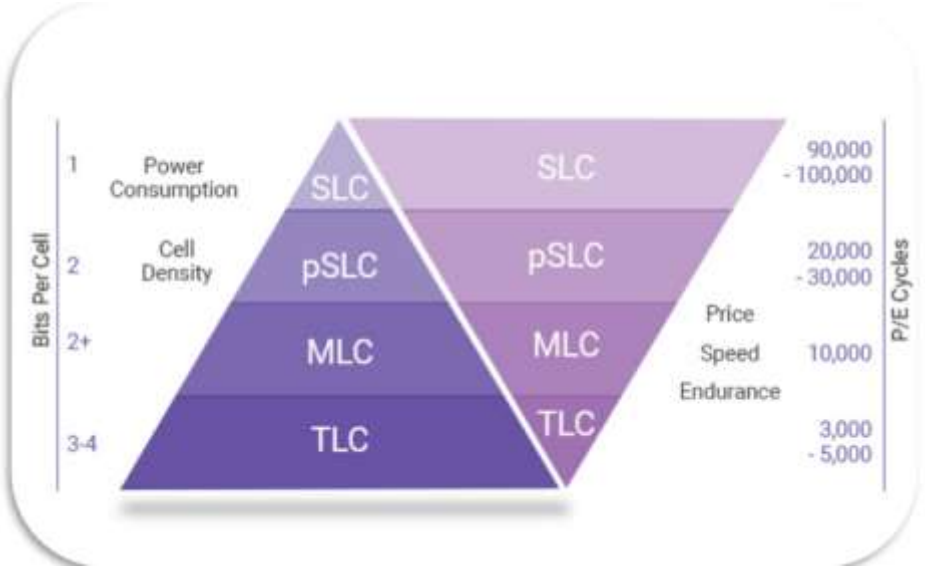
- CES 2026에서 공개된 엔비디아의 BlueField-4 DPU와 Next Storage 아키텍처는 데이터센터의 중심축을 CPU에서 GPU와 DPU로 완전히 이동시키며 SSD 수요를 재차 자극할 전망이다. 지금까지의 AI 인프라에서 SSD는 단순히 데이터를 저장하는 정적인 공간이었으나, 엔비디아가 BlueField-4를 통해 스토리지 제어권을 장악하면서 이제 SSD는 AI의 실시간 추론을 돕는 '컨텍스트 메모리'라는 핵심적인 연산 보조 계층으로 격상되었다. 특히 Agentic AI처럼 복잡한 문맥을 유지해야 하는 워크로드가 늘어남에 따라 발생한 'KV Cache' 처리량 문제를 해결하기 위해, 엔비디아는 기존의 느린 네트워크 기반 스토리지를 대신해 **DPU가 직접 SSD를 관리하는 초고속 전송 구조를 표준화**한다. 이 과정에서 BlueField-4는 CPU의 개입 없이 데이터를 직접 처리하여 지연 시간을 극단적으로 줄였고, 이는 전체 시스템의 토큰 처리량과 에너지 효율을 각각 5배씩 끌어올린 것으로 파악된다.
- 이는 결국 메모리 시장의 수요 폭증으로 이어진다. 실시간 AI 추론에 필요한 1억 IOPS 수준의 압도적인 속도를 맞추기 위해, 기존의 TLC나 QLC NAND를 그대로 쓰지 않고 **성능과 내구성이 극대화된 'pSLC(pseudo SLC) 모드'로 구동하는 방식이 필수적으로 요구**되고 있기 때문이다. **TLC 제품을 pSLC 모드로 전환하여 사용하면 실제 저장 용량은 1/3 수준으로 줄어들기 때문**에, 고객이 원하는 동일한 용량을 공급하기 위해서는 **물리적인 웨이퍼 투입량을 3~4배 이상 늘려야만 하는 구조적 변화가 발생**한다. 공급 제약 효과와 AI 서버의 강력한 수요가 맞물리며, 2026년 낸드 가격의 지속적인 상승을 견인하고, 이에 2026~2027년 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 업체들이 고부가가치 AI SSD 시장에서 유례없는 수익성을 확보하는 결정적인 기회가 될 가능성을 배제할 수 없다는 점을 주목한다.

그림. AI Server 요구사항: CPU Offloading → NVIDIA DPU & SSD 활용 확대



자료: NVIDIA, 유안타증권 리서치센터

그림. pSLC (pseudo SLC) vs. 여타 NAND 특징 비교



자료: 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

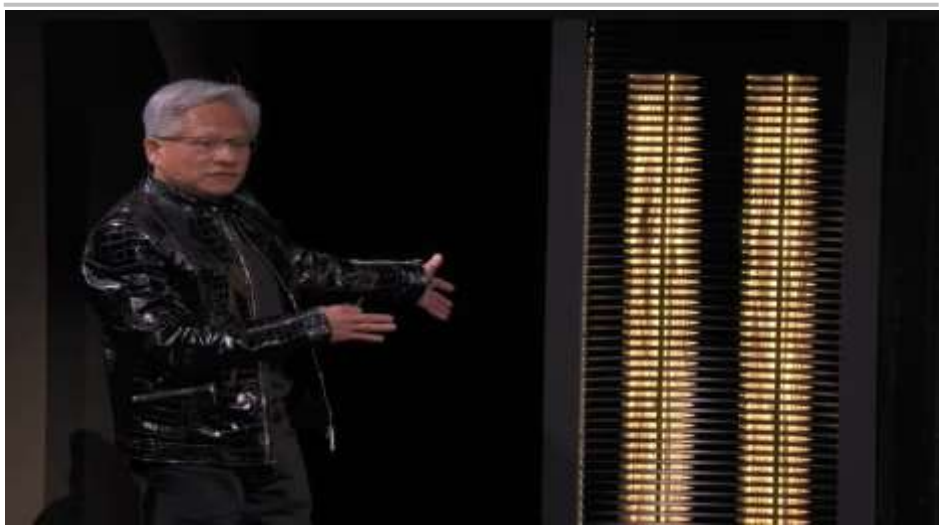
[NVIDIA Keynote] 냉각 시스템에 대한 시장 우려는 기우일 것

- 최근 CES 2026 기조연설에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 언급한 '차세대 데이터센터 내 수냉식 냉각기(Chiller) 불필요' 발언 이후, 주요 HVAC 섹터 주가가 큰 폭의 조정을 받았다. 하지만 이는 IT 인프라 내부로 냉각의 기술적 부가가치가 전이되는 패러다임 전환일 것으로 추정한다. 데이터센터 전체를 식히던 거대 설비 중심의 시대가 저물고, **칩 레벨에서 열을 직접 제어하는 정밀 액체 냉각(DLC) 및 액침 냉각 기술이 주도하는 인프라 2차 성장기에 본격 진입했다는 판단**이다.
- 이번 엔비디아 발언의 기술적 실체는 차세대 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)'의 압도적인 열 효율 설계에 근거한다. 베라 루빈은 개별 GPU의 TDP(열설계전력)가 1,800W를 상회하며 이전 세대인 Blackwell 대비 전력 밀도가 급증했음에도 불구하고, 유입 공기량은 일정하게 유지하면서 약 45도의 온수만으로도 안정적인 구동이 가능하도록 설계되었다. 이는 과거 극저온수를 생성하기 위해 막대한 전력을 소모하던 전통 칠러 단계를 생략하고 외부 공기와의 온도 차를 이용해 냉매를 식히는 드라이 쿨러(Dry Cooler) 체제로의 전환을 의미한다. 시장은 이를 냉각 인프라 수요의 감소로 오해하고 있으나, **실질적으로는 냉각의 난도가 '건물 외부'에서 '서버 랙 내부' 로 이동하며 고도화되고 있는 과정**일 것이다.
- 부가가치의 이동 관점에서 볼 때, 기존 건물 설비에 투입되던 CAPEX는 **이제 서버 랙 내부의 CDU(냉각 분배 장치), Cold Plate(액체 냉각판), 그리고 정밀 매니폴드 등 고사양 부품으로 재배치**되고 있다. 실제로 구글 TPU V8에 공급되는 AVC의 냉각 시스템 ASP가 층(Tray)당 약 $3,000에 육박한다는 점은 Rack 내부 부품들의 단위당 수익성이 오히려 극대화되고 있음을 반증한다. 또한 칩당 발열량이 한계를 돌파함에 따라 단순한 유체 순환을 넘어 양면 냉각(Dual-side Cooling) 및 액침 냉각 기술은 필수 요소가 될 것으로 예상한다. 대만 AVC(Asia Vital Components, 3017 TT), 일본 Furukawa Electric(5715 JP)에 중장기 수혜가 집중될 전망이다.

그림. AI 서버에 필요한 Liquid cooling 핵심 부품 및 공급사

자료: Trendforce(2024년 9월 기준), 유안타증권 리서치센터

그림. CES2026 NVIDIA Keynote에서 젠슨황은 Vera Rubin의 압도적인 열 효율 설계 언급



자료: NVIDIA(CES 2026), Youtube.com, 유안타증권 리서치센터

[AMD Keynote] 개방형 생태계를 추가하는 Helio rack-scale 플랫폼

- AMD의 CES 2026 키노트는 엔비디아가 자사의 독점적인 NVLink와 수직 계열화된 인프라를 통해 폐쇄적인 헤게모니를 강화하는 것과 대조적으로, 업계 표준에 기반한 '개방형 AI 생태계'를 통한 요타스케일(Yotta-scale) 컴퓨팅의 대중화를 재차 강조했다.
- 또한 메타(Meta)와 협력하여 공개한 'Helios' 랙 스케일 플랫폼을 통해 이러한 철학을 구체화했다. Helios는 특정 기업의 독점 규격이 아닌 OCP(Open Compute Project) 표준을 기반으로 설계된 더블 와이드 AI 랙으로, 어떤 데이터센터 환경에서도 누구나 쉽고 유연하게 도입하여 확장할 수 있는 표준화된 인프라를 지향한다.
- 특히 네트워킹 측면에서는 엔비디아의 폐쇄적인 인피니밴드(InfiniBand) 체제에 대응하여, 범용 업계 표준인 '울트라 이더넷(Ultra Ethernet)'과 펜산도(Pensando) 기술 기반의 DPU를 전면에 내세웠다. 이를 통해 수만 개의 랙을 하나로 통합하는 압도적인 확장성을 증명하며, **특정 벤더에 종속되지 않고도 거대 규모의 AI 클러스터를 구축**할 수 있음을 보여주었다.

그림. CES 2026에서 소개된 AMD Helio rack

자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

표. NVIDIA vs. AMD: AI 인프라 전략 비교

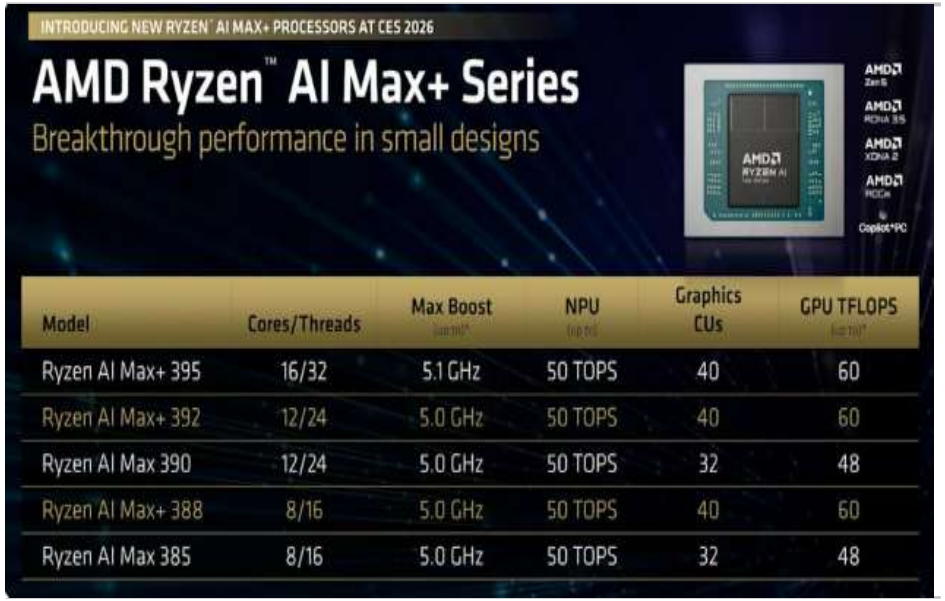
비교 항목	NVIDIA	AMD
핵심 철학	수직 계열화(Vertical Integration)	개방형 생태계(Open Ecosystem)
네트워킹 핵심	InfiniBand / NVLink	Ultra Ethernet / Pensando P4
주요 인수 기업	Mellanox (멜라녹스) HPC(고성능 연산) 네트워킹의 1인자. 독자 프로토콜을 통한 극강의 성능 지향	Pensando (펜산도) 시스코 출신 엔지니어들이 설립. 표준 기술(P4) 기반의 소프트웨어 정의 네트워킹 강자
전략적 목표	"The Golden Standard" 전용 하드웨어 결합으로 타사가 따라올 수 없는 최적 성능 구현	"The Open Fabric" 범용 이더넷 표준을 강화하여 대규모 클러스터의 확장성과 유연성 확보
스토리지/DPU	BlueField-4 DPU (SSD 직접 제어를 통한 성능 최적화)	Pensando Pollara 400 DPU (지능형 분산 서비스 및 대규모 노드 관리)
차별화 키워드	"독보적 성능의 수직 통합"	"표준 기반의 무한한 확장"

자료: 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

[AMD Keynote] AI Agent = '가성비 + 접근성' 요구 증가에 대응

- AMD는 2026년을 '에이전트의 해(Year of Agents)'로 선포하며, 데이터센터라는 거대 공장에 집중하는 엔비디아와 달리 클라우드부터 개인용 에지 기기까지 연결되는 'End-to-End AI 솔루션'의 대중화를 차별화 전략으로 내세웠다. AI 에이전트가 실질적으로 보급되기 위해서는 기술적 성능을 넘어 '가성비(TCO)'와 '접근성'이 핵심이라는 판단 하에, AMD는 누구나 손안에서 강력한 AI를 실행할 수 있는 환경을 구축하는 데 모든 역량을 집중하고 있다.
- Ryzen AI Max는 단순한 소비자용 프로세서를 넘어, 창작자와 개발자가 로컬 환경에서도 고성능 AI 모델을 자유롭게 돌릴 수 있는 세계 최강의 AI PC 플랫폼을 지향한다. 특히 소형 워크스테이션 환경에서 엔비디아의 DGX Spark 대비 달러당 1.7배 더 많은 토큰을 생성한다는 구체적인 수치를 제시하며, AI 인프라 구축의 경제적 장벽을 허무는 데 앞장서고 있는 것으로 파악된다. 이는 **고가의 전용 장비 없이도 고성능 AI 에이전트를 운영할 수 있음**을 의미하며, 기업과 개인이 AI를 도입할 때 겪는 비용 부담을 획기적으로 낮춰 진정한 AI 에이전트 시대의 개막을 앞당기는 핵심 동력이 될 전망이다.
- 한편 AI 기술이 데이터센터의 가상 공간을 넘어 물리적 세계와 상호작용하는 '행동하는 AI'로 진화하고 있음을 로봇공학의 혁신적 사례를 통해 증명했다. 이번 키노트에서 공개된 제트 엔진 기반의 비행 휴머노이드 'IronCub'은 복잡한 물리적 제어를 단말 수준에서 얼마나 정교하게 수행할 수 있는지를 보여주었고, 클라우드와 에지를 하나로 잇는 엔드투엔드 솔루션을 통해 고가의 전용 인프라에 의존하지 않고도 로봇과 인간이 일상에서 협력하는 시대를 앞당기겠다는 **AMD만의 실용주의적 AI 철학**을 보였다는 판단이다.

그림. AMD at CES 2026, Ryzen AI Max+ 시리즈 주요 스펙



Model	Cores/Threads	Max Boost	NPU	Graphics CUs	GPU TFLOPS
Ryzen AI Max+ 395	16/32	5.1 GHz	50 TOPS	40	60
Ryzen AI Max+ 392	12/24	5.0 GHz	50 TOPS	40	60
Ryzen AI Max 390	12/24	5.0 GHz	50 TOPS	32	48
Ryzen AI Max+ 388	8/16	5.0 GHz	50 TOPS	40	60
Ryzen AI Max 385	8/16	5.0 GHz	50 TOPS	32	48

자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

그림. AMD at CES 2026, 'IronCub'

자료: AMD(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

표. 삼성전자 목표주가 산정 테이블

	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
Adj BPS_P (비지배주주지분 제외)	24,340	28,971	35,342	37,528	39,406	43,611	50,817	52,002	57,930	63,763	78,987	93,984
PBR_P (End)	1.48	1.76	1.10	1.49	2.06	1.80	1.09	1.51	0.92	1.61	1.30	1.1
PBR_P (High)	1.50	1.99	1.53	1.53	2.06	2.22	1.57	1.51	1.53	1.76	1.42	1.2
PBR_P (Low)	0.89	1.23	1.08	0.98	1.07	1.57	1.02	1.05	0.86	0.80	0.64	0.5
PBR_P (Avg)	1.18	1.60	1.33	1.24	1.45	1.82	1.26	1.30	1.24	1.10	0.88	0.7
Target PBR												1.99
Target Price											**172,000**	171,711
Close Price (1월 9일)											**139,000**	
Upside potential											**24%**	

자료: 유안타증권 리서치센터, 주: Target PBR = 2016~2017년 PBR 밴드 상단 평균 값, 단위는 원, 배

표. SK하이닉스 목표주가 산정 테이블

	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A	2024A	2025F	2026F	2027F
Adj BPS_P (비지배주주지분 제외)	34,051	47,510	67,794	69,271	74,721	88,543	90,064	76,616	104,567	160,436	278,966	400,286
PBR_P (End)	1.31	1.61	0.89	1.36	1.59	1.48	0.83	1.85	1.66	3.30	1.90	1.32
PBR_P (High)	1.37	1.90	1.44	1.40	1.62	1.70	1.49	1.88	2.38	4.03	2.32	1.61
PBR_P (Low)	0.75	0.94	0.86	0.82	0.88	1.02	0.83	0.95	1.23	1.01	0.58	0.41
PBR_P (Avg)	1.00	1.35	1.16	1.09	1.19	1.37	1.13	1.41	1.71	1.86	1.07	0.75
Target PBR												2.66
Target Price											**910,000**	903,722
Close Price (1월 9일)											**744,000**	
Upside potential											**22%**	

자료: 업계 자료, 유안타증권 리서치센터, 주: Target PBR = 2019년 PBR Band 상단값 * Customized DRAM 경쟁력 프리미엄 40% 부여, 단위는 원, 배

[Appendix] 용어설명

반도체 용어 설명 – 1

NO.	용어	설명
1	CES (Consumer Electronics Show)	매년 1월 라스베이거스에서 열리는 세계 최대급 테크 전시/컨퍼런스. 기업들이 차세대 제품, 플랫폼 로드맵을 공개하는 '시그널' 이벤트로 활용됨
2	Keynote	행사 핵심 기조연설. 단순 발표가 아니라 플랫폼 방향성/표준/생태계를 선언하는 자리
3	데이터센터 (Data Center)	서버, 스토리지, 네트워크를 대규모로 운영하는 시설. AI 시대에는 전력, 냉각, 네트워크, 스토리지까지 포함한 인프라 산업으로 재평가됨
4	AI 인프라	AI 학습/추론을 수행하기 위한 서버, GPU/가속기, 메모리, 스토리지(SSD), 네트워크, 전력/냉각을 포괄하는 인프라 스택 전체
5	CPU (Central Processing Unit)	중앙처리장치로 범용 연산 담당. AI 시대에는 병렬 연산의 한계와 데이터 이동 병목 때문에 "모든 걸 CPU가 처리"하던 구조가 약화되는 중
6	GPU (Graphics Processing Unit)	그래픽처리장치이지만, 대규모 병렬 연산에 강해 AI 학습/추론의 핵심 가속기로 자리잡음
7	DPU (Data Processing Unit)	네트워크/스토리지/보안 같은 데이터 이동,처리 업무를 CPU 대신 전담하는 가속기. CPU 개입을 줄여 지연시간을 낮추고 전체 효율(성능/전력)을 높이는 목적
8	BlueField-4	NVIDIA의 DPU 라인업(BlueField) 4세대. CPU 개입 없이 데이터를 직접 처리하는 구조를 강조하며, 스토리지/네트워크 병목 완화의 핵심으로 언급됨
9	Next Storage	SSD를 "정적 저장공간"이 아니라 AI 추론을 보조하는 능동 계층으로 끌어올리는 차세대 스토리지 아키텍처(데이터 이동/캐시/컨텍스트 유지 역할 강화)
10	아키텍처 (Architecture)	시스템이나 컴퓨터가 어떤 구조로 설계되어 있고, 각 부품이 어떤 역할을 나눠 맡는지를 정한 전체 설계 방식
11	SSD (Solid State Drive)	낸드플래시 기반 저장장치. AI에서는 모델/데이터 저장을 넘어 "추론 시 필요한 컨텍스트를 빠르게 공급"하는 역할로 중요도가 상승
12	컨텍스트 메모리 (Context Memory)	AI가 대화/작업의 문맥(이전 정보)을 유지하기 위해 참고하는 메모리/저장 계층을 의미. 추론 품질,일관성을 좌우해 '보조 계층'의 가치가 커짐
13	Agentic AI	목표를 세우고(Goal) → 계획(Plan) → 실행(Act) → 피드백(Reflect)을 반복하는 형태의 AI 에이전트 워크로드. 문맥 유지,상태 관리 부담이 커 메모리/스토리지 병목을 유발하기 쉬움
14	워크로드 (Workload)	시스템이 처리해야 하는 작업 특성/패턴(예: 학습 vs 추론, 에이전트형 추론, 검색결합추론 등). 워크로드 변화가 인프라 수요(메모리/SSD/네트워크)를 바꿔놓음
15	Cache	CPU 내부에 위치해, 자주 사용하는 데이터를 미리 저장해 두고 DRAM 접근을 줄여주는 초고속 메모리

자료: CES, 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

[Appendix] 용어설명

반도체 용어 설명 – 2

NO.	용어	설명
16	KV Cache	Transformer 추론에서 Key/Value를 캐시로 저장해 다음 토큰 생성 시 재사용하는 구조. 컨텍스트가 길어질수록 KV 캐시 부담(용량/대역폭)이 급증해 병목 포인트가 됨
17	Transformer	글을 한 글자(또는 단어)씩 보면서 관계를 파악하는 AI 구조. "이 단어가 앞에 나온 어떤 단어와 관련 있는지"를 동시에 계산함
18	Transformer 추론	학습이 끝난 Transformer AI가 입력된 문맥을 바탕으로 다음 단어를 하나씩 계산해 결과를 만들어내는 과정
19	네트워크 기반 스토리지	스토리지가 네트워크를 거쳐 접근되는 구조. 성능이 네트워크 지연/혼잡에 크게 좌우되어 초저지연 추론에는 한계가 생기기 쉬움
20	지연시간 (Latency)	요청→응답까지 걸리는 시간. AI 추론에서는 '정확도'만큼이나 '지연시간'이 사용자 경험/서비스 단가(TCO)에 직접 영향을 줌
21	토큰 (Token)	AI가 문장을 이해하고 생성할 때 사용하는 최소 단위의 텍스트 조각
22	토큰 처리량 (Token Throughput)	초당 처리 가능한 토큰 수(생성 속도). 모델 성능뿐 아니라 메모리/네트워크/스토리지 병목에 크게 좌우됨
23	에너지 효율	동일한 연산/처리량을 더 적은 전력으로 수행하는 정도. 데이터센터는 전력이 비용의 핵심이라 효율 개선이 곧 수익성/확장성으로 연결됨
24	IOPS (Input/Output Operations Per Second)	스토리지의 초당 입출력 작업 처리능력. AI 추론에서 요구되는 '초고속 랜덤 IO' 수준을 설명할 때 사용됨
25	NAND (낸드)	비휘발성 플래시 메모리. SSD의 핵심 원재료(셀 구조에 따라 TLC/QLC 등으로 구분)
26	SLC (Single-Level Cell)	낸드 메모리 한 셀에 하나의 정보만 저장해 가장 빠르고 내구성이 뛰어난 저장 방식. TLC, QLC 대비 비용 부담이 있음
27	TLC (Triple-Level Cell)	셀 1개에 3비트를 저장. 용량 효율은 좋지만 속도/내구성은 SLC 대비 낮아 고성능 용도에서 제약이 생김
28	QLC (Quad-Level Cell)	셀 1개에 4비트를 저장. 비용/용량 효율은 좋지만, 고성능/고내구 요구 환경에서는 성능 저하/수명 이슈가 커질 수 있음
29	pseudo SLC	'가짜 SLC'라는 뜻. 실제 SLC 낸드를 쓰는 게 아니라, TLC/QLC를 SLC 방식으로 운용해 성능을 끌어올리는 운영 모드. 속도, 내구성을 크게 올리는 대신, 동일 물리 셀로 저장 가능한 용량이 감소(실질 용량 축소)
30	AI 서버	AI 학습/추론을 위한 GPU/가속기 중심 서버. 일반 서버 대비 메모리 대역폭, 스토리지 IOPS, 네트워크 요구 수준이 훨씬 높음

자료: CES, 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

[Appendix] 용어설명

반도체 용어 설명 – 3

NO.	용어	설명
31	AI SSD	AI 워크로드(특히 추론) 최적화 SSD를 지칭. 높은 IOPS/지연시간/내구성 요구 때문에 낸드 운용 방식(pSLC 등)과 제품 믹스가 달라질 수 있음
32	HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)	건물 단위의 공조/환기/냉난방 시스템. 데이터센터에서는 전통적으로 '시설(건물) 냉각'의 대표 영역
33	수냉식 냉각기 (Chiller)	냉수를 만들어 시설 전체를 식히는 대형 냉각 설비. 데이터센터 냉각 CAPEX의 주요 항목으로 언급됨
34	IT 인프라	서버/스토리지/네트워크/전력/냉각 등 IT 서비스를 가능하게 하는 기반 시설 전반
35	정밀 액체 냉각 (DLC, Direct Liquid Cooling)	'칩/서버에 가까운 위치'에서 액체로 직접 열을 빼는 방식. 랙 내부 부품(콜드플레이트, CDU 등)의 부가가치가 커짐
36	액침 냉각	서버를 절연 냉각액에 담가 직접 열을 제거하는 방식. 발열 밀도가 극단적으로 올라갈 때 유력한 대안으로 거론됨
37	베라 루빈 (Vera Rubin)	NVIDIA 차세대 플랫폼으로 고발열 환경에서도 특정 냉각 방식(저온 칠러 의존)을 줄일 수 있는 설계 변화의 근거로 사용됨
38	Blackwell	NVIDIA GPU 아키텍처/플랫폼 세대명. 차세대(베라 루빈)와의 전력 밀도/냉각 난이도 비교에 사용됨
39	전력 밀도	동일 면적/부피에서 발생하는 전력,열의 밀집 정도. 전력 밀도가 높아질수록 냉각은 '시설'보다 '칩/랙 내부' 기술이 핵심이 됨
40	TDP (Thermal Design Power)	(열설계전력). 칩이 정상 구동 시 발생시키는 열/전력의 설계 기준치. 냉각 설계 난이도의 바로미터
41	드라이 쿨러 (Dry Cooler)	외기(외부 공기)와의 온도 차를 활용해 냉매를 식히는 장치. 칠러처럼 '극저온 냉수 생산'에 드는 전력 부담을 줄이는 방향의 전환으로 설명됨
42	서버 랙 (Rack)	서버/네트워크/전력/냉각 모듈을 수납하는 표준 프레임. AI 시대에는 랙 단위로 전력,냉각,네트워크가 재설계되는 경향이 강함
43	CDU (Cooling Distribution Unit)	랙 내부에서 냉각수를 분배,압력,온도 등을 제어하는 장치
44	Cold Plate	칩(주로 GPU/CPU)에 밀착해 액체로 열을 전달/흡수하는 냉각판. 고발열 칩에서 필수 부품
45	매니폴드 (Manifold)	냉각 유체의 유입/유출을 여러 갈래로 분배,제어하는 고정밀 부품. 랙 내부 냉각 고도화의 대표 부품

자료: CES, 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

[Appendix] 용어설명

반도체 용어 설명 – 4

NO.	용어	설명
46	Tray	랙 내부의 층/모듈 단위(서버/냉각 구성 요소를 장착하는 단위)
47	TPU	Google의 AI 가속기(Tensor Processing Unit). GPU와 별개로 대형 CSP들이 독자 칩으로 생태계를 구축하는 사례로 자주 거론됨
48	양면 냉각 (Dual-side Cooling)	칩/모듈의 한쪽만이 아니라 양쪽에서 열을 제거하는 냉각 방식. 발열이 한계를 넘을 때 필요한 고도화 옵션으로 거론
49	NVLink	NVIDIA의 독자 GPU 인터커넥트. 폐쇄적(독점) 인프라/수직계열화 전략의 상징으로 비교 언급됨
50	InfiniBand	초저지연,고대역폭 네트워크 기술/표준. AI 클러스터에서 많이 쓰이며, '폐쇄적 네트워크 체제'의 예시 중 하나
51	Ultra Ethernet	차세대 이더넷 기반 표준화 흐름. 특정 벤더 종속을 줄이고 대규모 확장성을 노리는 방향으로 언급
52	Pensando	AMD가 확보한 DPU/네트워킹 기술 브랜드. 표준 기반 네트워크/DPU 전략의 구성 요소로 언급됨
53	Helios	AMD가 메타와 협력해 공개한 랙스케일 플랫폼 명칭. '표준 기반 더블 와이드 AI 랙'으로 설명됨
54	rack-scale 플랫폼	서버 1대가 아니라 '랙 전체'를 하나의 컴퓨팅 단위로 설계/운용하는 방식. 전력,냉각,네트워크를 랙 레벨에서 최적화하는 접근
55	더블 와이드 AI 랙	더 큰 전력/냉각/가속기 밀도를 수용하기 위한 확장형 랙 규격
56	OCP (Open Compute Project)	데이터센터 하드웨어를 개방형 표준으로 설계,공유하는 프로젝트/생태계. 특정 벤더 독점 규격을 피하는 근거로 사용됨
57	요타스케일 (Yotta-scale)	초초대규모 컴퓨팅 스케일을 지칭하는 표현. AI 확장 경쟁에서 "수만 개 랙을 하나로 묶는 수준"의 스케일 논의에 쓰임
58	AI Agent	사람의 지시를 받아 목표를 스스로 계획하고, 여러 단계를 거쳐 일을 수행하는 자율형 AI
59	End-to-End AI 솔루션	데이터센터(클라우드)부터 개인용/엣지 기기까지 전 구간에서 AI를 실행/배포할 수 있는 통합 솔루션
60	TCO	Total Cost of Ownership(총소유비용). 장비 가격뿐 아니라 전력,냉각,운영까지 포함한 전체 비용. AI 보급의 핵심 제약 조건
61	접근성	기술을 "누가/어디서/얼마나 쉽게" 쓸 수 있는지. AI PC/엣지 확산 논리에서 반복 등장하는 키워드
62	Ryzen AI Max	AMD의 AI PC/로컬 AI 실행을 강조한 프로세서 플랫폼 명칭
63	DGX Spark	NVIDIA의 AI 시스템/플랫폼 명칭. '달러당 토큰 생성량' 같은 비용 대비 성능 비교의 기준으로 언급

자료: CES, 업계 자료, 유안타증권 리서치센터

고선영

전기전자

02 3770 3525

sunyoung.kou@yuantakorea.com

PART 2

The Age of Personalization

개인화의 시대 (feat. 전장)

전기전자) Physical AI의 적용, 가전에서 전장까지. 개인화 시대의 본격화

- 이번 CES 2026에서 글로벌 전기전자(가전) 기업들이 공통적으로 제시한 핵심 메시지와 이에 연계된 투자 아이디어는 크게 두 가지로 요약된다. **첫 번째는 AI 기반 개인화 전략으로 이는 AI를 단일 기능이 아닌 B2C, B2B 대상 사용자 맥락을 이해하는 통합 솔루션으로 진화시키는 방향**이다. 두 번째는 **기존 가정(Home)과 제조업 현장에 한정되었던 AI 적용 범위를 모빌리티 및 전장 영역으로 확장하며 AI의 활동 반경을 고정된 공간에서 이동 가능한 환경으로 넓히려는 시도**다.
- 기조연설과 전시 내용들을 종합해봐도 아직까지 AI의 실질적인 적용 범위는 여전히 환경 변화가 제한적인 가정과 산업 현장에 집중되어 있다. 실제로 삼성전자, Hisense, LG전자 등 글로벌 가전 기업들은 CES 부스를 통해 가정(Home)에 대한 장악력을 강화하는 전략을 구사했으며 AI 기반 가전은 물론 로봇 제품을 전면에 배치해 AI가 생활 공간 전반을 관리 및 조율하는 구조를 강조했다. 이는 **AI 기술의 확산보다 우선적으로 활용 깊이의 심화에 초점을 맞춘 흐름**으로 해석된다.
- 특히, LG전자는 주변 환경을 스스로 인지 및 판단해 최적의 상태를 구현하는 AI 기반 홈로봇 LG CLOiD(LG클로이드)를 통해 차별화된 메시지를 제시했다. 단순 보조 기기를 넘어 AI가 물리적 공간을 직접 제어하는 단계로 진입했음을 보여주며 로봇 기반 홈 솔루션 시장에서 동사가 지닌 선도적 포지션을 부각시킨 전략이었다. 결국 단기 이벤트성 전시를 넘어 **향후 AI 기반 홈 로봇 및 이후 전장으로 이어지는 구조적 성장 경로에서 동사의 수혜 가능성을 시사하는 대목**으로 판단된다.

대표 전기전자 기업인 LG전자 전략 ① : 공감지능 기반 개인화 전략 – AI홈로봇 LG CLOiD

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

대표 전기전자 기업인 LG전자 전략 ② : AI 적용 범위 확대 – 전장에 대한 강조

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG전자 개인화 시대의 혁신 1) 가전과 AI, 2) 홈로봇(LG CLOiD)

LG전자 – 전자레인지에 접목된 디스플레이 및 AI 기술 ①

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG전자 – 홈로봇 LG클로이드(LG CLOiD) 시현 ①

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG전자 – 전자레인지에 접목된 디스플레이 및 AI 기술 ①

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG전자 – 홈로봇 LG클로이드(LG CLOiD) 시현 ②

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Hisense 개인화 시대의 혁신 1) 가전과 AI, 2) AI Robot

냉장고에 접목된 디스플레이 및 AI 기술

자료: CES 2026, 유안타증권 리서치센터

AI Robot 시현 ①

자료: CES 2026, 유안타증권 리서치센터

Home 관리에 중점을 둔 AI Agent Suite

자료: CES 2026, 유안타증권 리서치센터

AI Robot 시현 ②

자료: CES 2026, 유안타증권 리서치센터

LG전자의 공감지능 기반 B2C 개인화 전략 - 'Innovation in tune with you'

- LG전자는 CES 2026에서 로봇, 모빌리티, 프리미엄 디스플레이 기업이 집중되는 핵심 전시장인 LVCC 센트럴홀(Central Hall) 내 최대 규모 수준의 부스를 확보하며 전시의 중심에 섰다. 이는 단순한 전시 규모를 넘어 AI 시대 전기전자 플랫폼 경쟁에서의 전략적 포지셔닝을 명확히 드러낸 행보로 판단된다.
- 전시 이전 공개된 CES 2026 혁신상(Innovation Awards) 결과에서도 동사의 기술적 존재감은 분명했다. LG전자는 최고 혁신상(Best of Innovation)을 포함해 총 18개의 혁신상을 수상하며 영상 디스플레이와 AI 융합 제품 전반에서 기술 경쟁력을 공식적으로 입증했다.
- 수상 내역은 OLED 기반 디스플레이 기술과 AI 프로세싱 역량이 결합된 제품군에 집중되어 있는데 이는 프리미엄 TV 및 차세대 디스플레이 플랫폼에서의 구조적 우위를 재확인시키는 지표로 해석된다. 동시에 공감지능을 전면에 내세우며, AI를 기반으로 한 사용자 경험의 중심에 디스플레이를 핵심 인터페이스로 재정의했다는 점이 이번 CES에서의 핵심 중 하나라고 판단된다. 또한 이는 이전 페이지에서 강조한 전장 영역으로의 확대와도 맥락을 같이 하는 부문이다.

LG전자 – CES 부스

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG전자 – 디스플레이 전시

자료: LG전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

삼성전자(The First Look) & Hisense(Innovating A Brighter Life)

삼성전자 – The First Look, Wynn Hotel

자료: 삼성전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Hisense – Innovating A Brighter Life, LVCC Central Hall

자료: Hisense(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

삼성전자 – 디스플레이 전시

자료: 삼성전자(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

Hisense – 디스플레이 전시 (RGB MiniLED)

자료: Hisense(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG 내 전장 포트폴리오 확장, LG이노텍의 B2B 개인화 전략

- 앞서 언급되었던 전장으로의 AI 적용 영역 확대는 같은 계열사인 LG이노텍에서도 확인이 되고 있다. 이번 CES 2026에서 동사는 **미래 모빌리티를 단독 테마로 한 전시 부스를 구성하고 기존 하드웨어를 넘어 AI 기반 소프트웨어가 결합된 전장 통합 솔루션을 공개**했다. 특히 완성차 브랜드별 디자인 콘셉트에 맞춰 픽셀 크기와 배열을 유연하게 구현할 수 있는 초슬림 픽셀 라이팅 모듈(Nexlide Pixel, Ultra Thin Pixel Lighting Module), 차량 내부 인식을 고도화할 수 있는 언더 디스플레이 카메라 모듈(Under Display IR Camera) 등을 핵심 제품으로 제시하며 기존 스마트폰을 넘어 전장으로의 영향력 확대 의지를 분명히 밝혔다.
- 동사는 기존 차량 전장 부품에서 축적한 기술을 바탕으로 카메라를 넘어 Radar, LiDAR까지 확장된 자율주행에 필수적인 센싱 관련 포트폴리오 구축에 집중하고 있다. 센싱(Sensing)은 AI를 접목시킨 전장, 즉 자율주행 구현 과정에서 레벨4, 5 자율주행의 신뢰성과 안전성을 좌우하는 핵심 요소 중 하나로 LG 계열사 단에서 집중하고 있는 전장 포트폴리오 확장 상황에서 동사만이 가지고 있는 강점이 된다. LG이노텍은 **센서 하드웨어 경쟁력에 소프트웨어를 결합한 센서 퓨전 역량을 강화하며 다양한 고객의 자율주행 전략에 유연하게 대응 가능한, 즉 B2B 단에서의 개인화 전략을 형성**하고 있는 것으로 판단된다.

LG이노텍 – CES 부스

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – 자율주행의 센싱을 담당하는 Vision 강조. 기존 Camera를 넘어 LiDAR, RADAR까지

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – 자율주행 컨셉카 Mockup ①

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – Nexlide Pixel(초슬림 픽셀 라이팅 모듈, CES 2026 혁신상 수상)

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – 자율주행 컨셉카 Mockup ② Nexlide Pixel + Air 탑재

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – Nexlide Air

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – Under Display IR Camera 시현 ①

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – Under Display IR Camera 전시

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

LG이노텍 – Under Display IR Camera 시현 ②

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

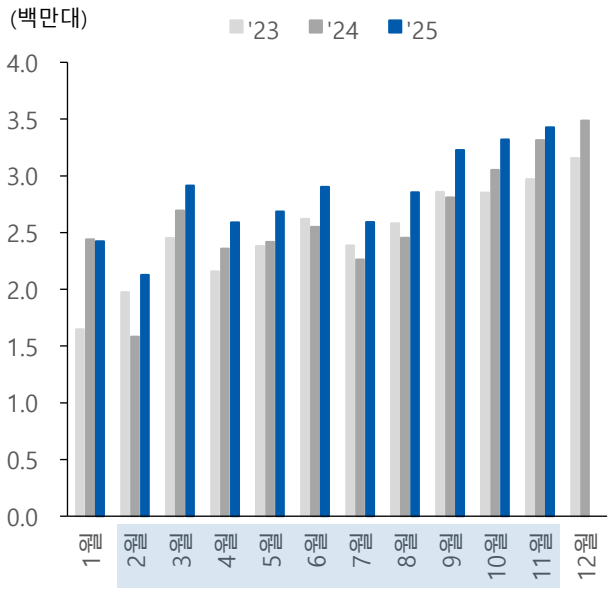
LG이노텍 – Fusion Sensing Module

자료: LG이노텍(CES 2026), 유안타증권 리서치센터

전기전자 결론 및 투자전략 – 26년 Key는 '전장'

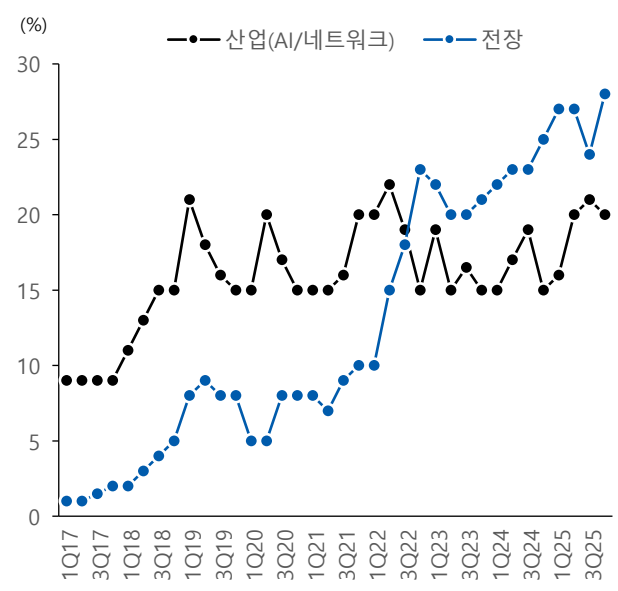
- AI 기술의 진화는 연산 성능 경쟁을 넘어 적용 영역과 활용 방식의 확장 국면에 진입하고 있다. 이번 CES 2026에서 도출된 전기전자 관련 투자 아이디어는 크게 두 가지로 **1) AI 기반 B2C 및 B2B 개인화 전략의 고도화, 2) 모빌리티 및 전장 영역으로의 AI 적용 확대다**. 이 가운데 단기적으로는 실질적인 수요 기반의 매출 반영이 진행 중인 전장 기반 B2B 개인화 전략에 주목할 필요가 있다고 판단하며 관련 종목으로는 해성디에스(목표주가 NR, 중국 전기차 시장 성장이 이끌 견조한 리드프레임 수요), LG이노텍, 삼성전기를 제시한다.
- 전장 산업은 전기차를 넘어 내연기관 및 하이브리드 차량으로 저변이 확대되고 있으며 이에 따라 MLCC와 기판 등 핵심 전기전자 부품의 전장 침투율도 구조적으로 상승하고 있다. 실제로 TDK는 이번 CES에서 고온 및 고전압 환경에 최적화된 전장용 MLCC(CeraLink Capacitor)를 공개하며 전장 부품 수요가 단순 물량 확대를 넘어 고사양 및 고부가 중심으로 전환되고 있음을 시사했다.
- **다만 이번에 CES 2026에서 확인된 기술들이 전기전자 섹터 전반의 주가를 단기간에 상방으로 이끌기에는 어렵다고 판단된다**. 전장 관련 매출 비중이 제한적인 상황에서 **공개된 신기술과 실제 제품 출시 사이에는 불가피한 시차가 존재**하기 때문이다. 그러나 **이미 형성된 수요와 매출 반영이 진행 중인 세부 영역들에 대한 선별적 접근은 유효하다**는 점을 강조한다.

중국 '23~25년 월간 전기차 판매량



자료: MarkLines, 유안타증권 리서치센터

삼성전기 컴포넌트 사업부 내 전장 영향력 점차 확대



자료: 삼성전기, 유안타증권 리서치센터

TDK – 전장에 특화된 CeraLink Capacitor 전시

자료: 유안타증권 리서치센터

김용민

조선/자동차

02 3770 5606

yongmin.kim@yuantakorea.com

PART 3

천일양병 일일용병

자동차: 천일양병 일일용병 – 한 순간을 위해 오래 준비한 것

- 자동차 업종내 CES 주요 관심사를 하나의 기업으로 정의하자면 보스턴 다이내믹스 (BD). 모빌리티 관점의 업종 내 기존 트리거보다 로보틱스 신사업에 대한 집중도가 높아진 CES 이후 던져야 할 질문은 “자동차 업종내 기업들이 로보틱스 사업 전개에서 유리한 것은 무엇인가?”
- 주요 기업들의 로보틱스 사업에 대한 전개는 주식시장 관점의 모멘텀이 발생하기 이전부터 지속되어 왔으며, 이것이 CES를 통해 중간 검증의 기회로 활용되었음.
- 로보틱스 태동기인 현재의 단기 기대감에 의존하기보다 중장기 사업 확장의 가시성이 높은 기업에 집중하는 것이 필요함. 연구개발 및 파일럿 생산의 경우 제한적인 기반으로도 사업을 영위할 수 있겠으나, 결국 상용화 이후 이익발생 가능성을 논의하는 구간에서는 검증된 생산체계를 보유한 기업들이 우세할 것이라 예상.

현대차는 2019년 CES 당시에도 “걸어다니는 자동차“ 컨셉카를 공개했고…

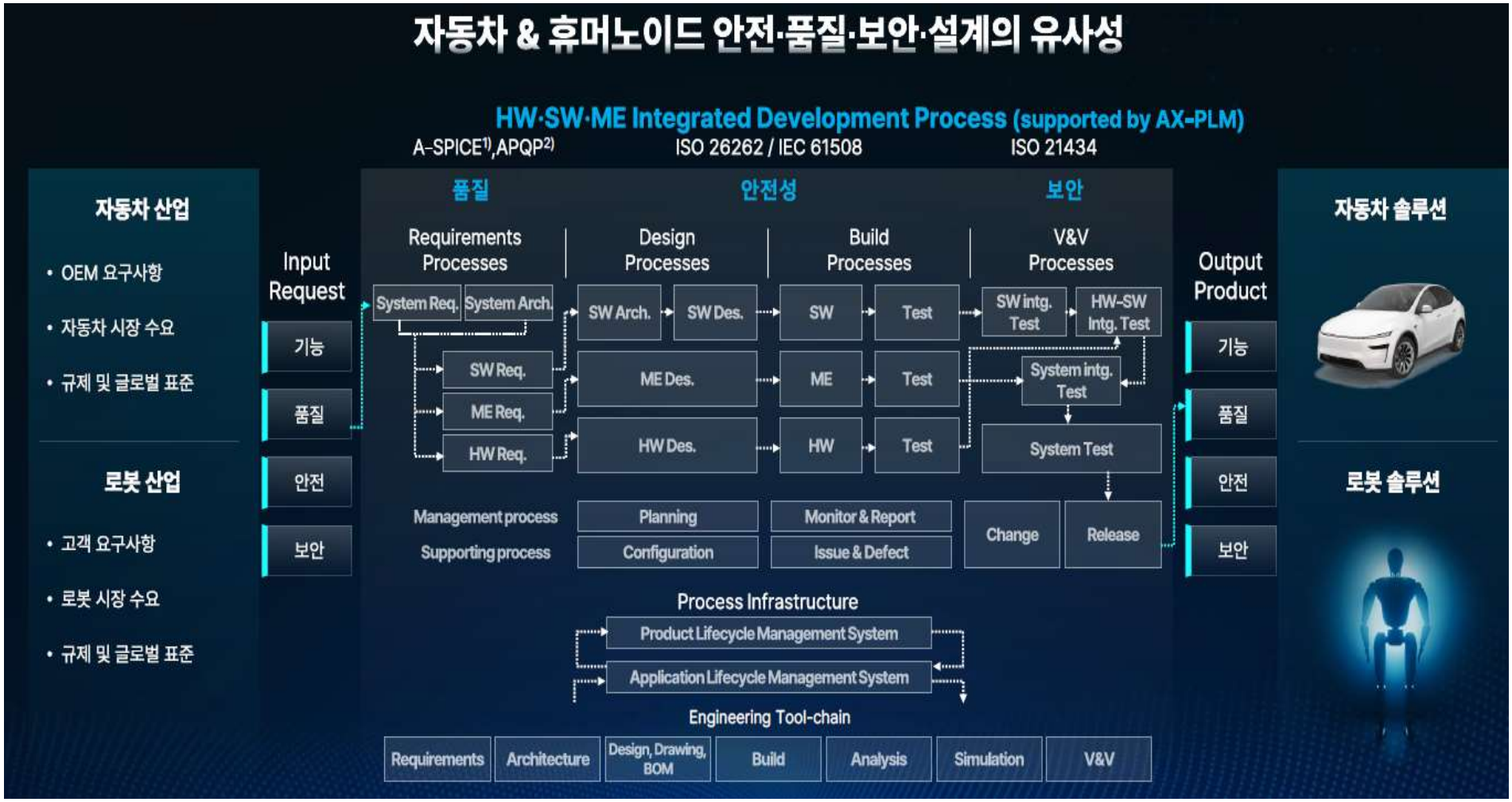
자료: 현대차, 유안타증권 리서치센터

…2020년말 BD 인수 합의 직후에도 걸어다니는 무인 모빌리티를 소개하였음

자료: 현대차, 유안타증권 리서치센터

자동차: 천일양병 일일용병 – 한 순간을 위해 오래 준비한 것

자동차 업종 로보틱스 (특히 휴머노이드) 사업 전개 관점 유사성



자료: HL만도, 유안타증권 리서치센터

자동차: 천일양병 일일용병 – 한 순간을 위해 오래 준비한 것

연구개발과 파일럿 생산이 아닌 본격 상용화 단계에서 필요한 것은 양산 품질 확보 기술력과 원가 경쟁력

자료: HL만도, 유안타증권 리서치센터

자동차: 천일양병 일일용병 – 한 순간을 위해 오래 준비한 것

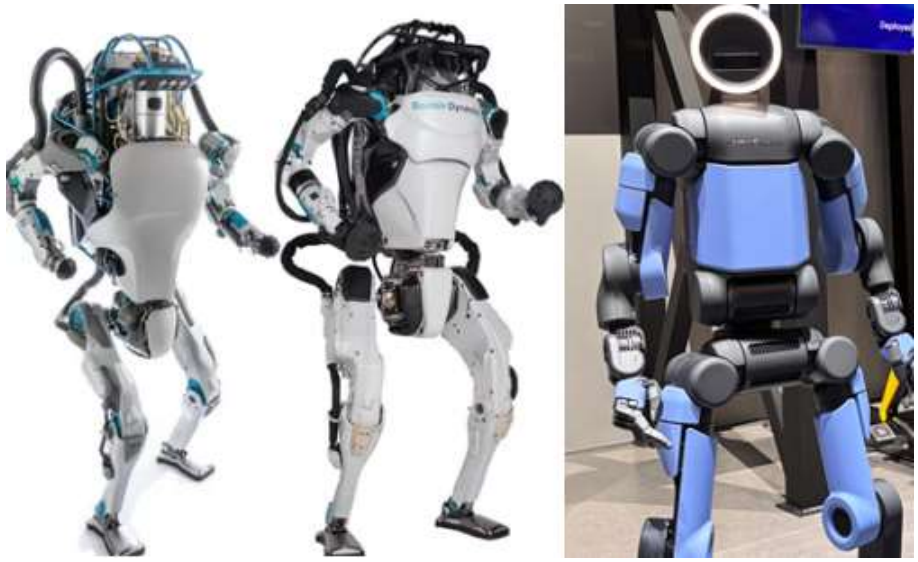
- BD는 2024년 4월, 기존 유압식 구조에서 전기식 구조로 전환을 발표했으며 이는 본격적 상용화 의지의 발현이었음.
- 유압식 로봇 구동 방식은 매우 높은 출력을 자랑하나 상용화 단계에서 여러 가지 제약이 존재하기에, 연구개발 단계에서는 유압식 휴머노이드로 퍼포먼스 능력에 대한 개발을 진행한 뒤 (ex. 여러 매체에서 공개된 파쿠르) 상업적 효율성을 확대하기 위해 완전 전동화를 발표.
- 현대차그룹 조지아 공장에 2028년 투입되는 Atlas 휴머노이드는, 비용 감축과 같은 단기적 효용보다는 BD가 최대주주인 현대차그룹의 지원 하에 non-captive 고객 유치 이전 실질적 상용화의 가능성을 검증하는 수단이 될 것이라 예상.

유압식 대비 상용화 관점에서 유리한 전기식 휴머노이드

	유압식	전기식
작동원리	액체의 압력	전기 모터가 직접 구동
출력	**매우 높음**	**낮음**
정밀성	유체압력의 비선형성으로 정밀 제어 어려움	전기 신호로 제어되어 정밀 동작 용이
응답 속도	빠르나 제어 복잡도 존재	매우 빠르고 정확
구조 복잡도	펌프, 밸브, 유체 회로로 복잡	모듈식 구조로 단순화, 경량화 가능
유지보수	**유체 누출, 고압 케이싱 등 상용화 부담**	**부품 교체, 점검이 비교적 쉬움**
응용 분야	중장비	정밀 로봇, 휴머노이드

자료: 유안타증권 리서치센터

기존유압식과 달라진 Atlas: 한 눈에 봐도 깔끔한 모습



자료: 유안타증권 리서치센터

자동차: 천일양병 일일용병 – 한 순간을 위해 오래 준비한 것

- BD에 대한 관심이 자본시장에서 증폭되는 이유는 현대차그룹 (정의선 회장 포함)의 지분이 25년말 기준 90%에 도달했으며, 올해 6월 FI로 참여하고 있던 소프트뱅크의 풋백옵션 행사가능일이 도래하기 때문.
- 1) 정의선 현대차그룹 회장의 사재가 지속 투입되었고, 2) 로보틱스에 대한 자본시장의 관심도가 최고조에 도달한 구간에서 3) 이에 대한 적정가치가 국내 자동차 업종 내 주요 기업들에 반영되고 이후 기존의 주요 부품 공급사에게 낙수효과가 발생할 수 있는지에 대한 예상이 필요한 시점.
- 소프트뱅크는 올해 6-7월 풋백옵션을 행사할 것이며, 이로 인한 현대차그룹 지분 100%를 달성 (혹은 제3자 파트너쉽으로 일부 지분 보유)한 이후 BD의 기업공개에 대한 작업이 본격적으로 착수될 것이라 예상.

연도별 BD 지분구조와 누적투자금액

(십억 원)	2021	2022	2023	2024	2025
현대글로비스	10.0%	10.3%	10.6%	11.0%	11.3%
HMG Global	50.0%	51.7%	52.8%	54.8%	56.3%
정의선 회장	20.0%	20.7%	21.1%	21.9%	22.5%
소프트뱅크	20.0%	17.4%	15.5%	12.4%	10.0%
투자금액 (누적)	1,420	1,660	1,863	2,402	3,115

자료: DART, 유안타증권 리서치센터, 주: 소프트뱅크의 경우 최초 2,840억 (21년 당시 20%) 이후 출자 붕찹

기존 FI 소프트뱅크의 풋백옵션

	보통주 매도청구권
청구권 대상회사	Boston Dynamics, Inc. 기존주주
발행일	**2021-06-21**
대상주식	Boston Dynamics, Inc. 기존주주의 보통주
행사가능일	1) ~~거래종결일로부터 4년 시점 이전에 IPO를 못 할 경우 4년시점부터 25년 10월 31일까지~~ 2) **거래종결일로부터 5년이 경과한 시점부터 30일 내**

자료: DART, 유안타증권 리서치센터

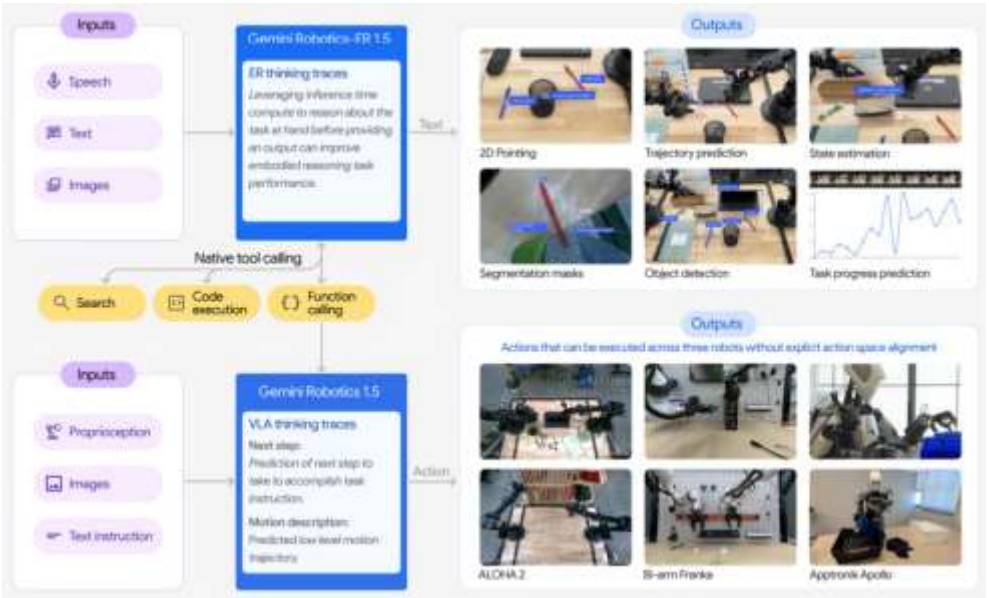
구글 딥마인드 파트너십: 우리 아틀라스가 운동도 잘하고 공부도 잘하고

- BD와 구글의 딥마인드가 휴머노이드 인공지능 기반 설립을 위해 파트너십 체결을 발표. 이는 BD의 물리적 퍼포먼스와 딥마인드의 AI 학습능력을 결합하는 것으로, 규칙 기반 제어 (Rule-based)가 아닌 시각-언어-행동 (VLA) 통합 AI 모델을 개발해 로봇 지능 자체를 높이려는 시도.
- 이로써 휴머노이드 로봇을 단순 기계에서 물리 세계의 학습 모델로 전환, 로봇 제조 산업이 아닌 AI 플랫폼 산업으로의 확장을 노리는 것. 딥마인드의 Gemini Robotics는 이미 자유도 (좌표계)가 서로 다른 로봇에게 같은 명령 (집는다, 민다, 넣는다 등의 추상적 개념)을 내릴 수 있는 수준에 도달.
- 하드웨어 관점에서 기술력과 원가경쟁력 모두 확보한 중국 휴머노이드 업체가 Rule-based 제품을 고객사의 니즈에 맞춰 생산하기 때문에, 향후 이를 넘어설 수 있는 분야는 결국 지속적인 학습을 통한 고성능 휴머노이드를 확보하며 범용성 관점에서의 시장 선점을 노리는 전략이라 판단.

중국의 UBTech, 이미 Walker S2와 같은 상용화 휴머노이드 하드웨어를 팔고 있으나…

자료: UBTech , 유안타증권 리서치센터

구글과 BD가 하려는 일은 체화된 추론 (Embodied Reasoning)이 가능한 뇌를 만드는 것



자료: Google deepmind, 유안타증권 리서치센터

휴머노이드로 인한 생산 비용 절감에 대해서는 여전히 보수적 접근

- BD의 Atlas가 현대차그룹의 생산시설 투입이 본격화될 경우 직접적인 비용 절감 요인이 될 수 있다는 관점에 대해서는 보수적 접근을 유지.
- 1) 실제로 로봇이 인력을 대체할 수 있다 하여도 고용구조상 빠른 대체가 불가능하며, 2) 오히려 초기 Capex로 인한 감가상각비가 인건비의 절감폭 대비 높을 가능성 존재하며 3) 2028년 현장에 투입되는 로봇에 대한 예상치를 손익 단계에서 긍정적으로 바라보는 것 자체가 매우 낙관적인 접근.
- 오히려, 해가 지날수록 자연감소하는 국내 생산직 인원의 감소에서 발생할 수 있는 마찰에 대한 보완적 수단으로 접근하는 것이 적절. 로봇이 생산현장의 인간을 대체한다는 전제는, 현재의 고용체제 내에서 은퇴의 가속화가 아닌 채용의 감소 측면 역할이 더 클 것.

생산직 자연감소에 따른 연간 인건비 절감 시나리오 (단위: 명, 십억원)

	2024	2025	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
신규 고용 인원	800	800	300	300	300	300	300
은퇴 인원	2,402	2,650	2,674	2,301	2,436	2,032	1,659
연간 순 은퇴 인원	1,602	1,850	2,374	2,001	2,136	1,732	1,359
누적 순 은퇴 인원	3,590	5,440	7,814	9,815	11,951	13,683	15,042
24년 대비 연간 인건비 절감 효과 (십억 원)							
퇴직자 평균 인건비 1억 가정시		185	422	623	836	1,009	1,145
퇴직자 평균 인건비 1.3억 가정시		241	549	809	1,087	1,312	1,489
퇴직자 평균 인건비 1.5억 가정시		278	634	934	1,254	1,514	1,718

자료: 현대차 노조, 유안타증권 리서치센터

업종의 역설 – 특장점의 발현보다 새로운 지평에 대한 기대감이 반영된 상황

- 휴머노이드가 큰 반향을 불러온 반면, 현대차그룹내 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 Mobed와 H-Motion 브랜드의 주차로봇에는 상대적 관심이 저조한 모습을 보임.
- 기존 자동차 업종내 특장점과 시너지가 발현될 수 있는 바퀴 달린 로봇에 대한 기대감보다는, 휴머노이드와 같은 완전한 신사업으로의 확장에 대한 시장의 관심이 더 높다는 점을 시사하나, non-captive 수주시 이로 인한 실질적 이익 가시성에 대한 리레이팅 또한 발생할 수 있음.
- 현대차의 목표주가를 기존 37만 원에서 43만 원으로 상향, 현대모비스의 목표주가를 기존 45만 원에서 49만 원으로 상향. BD의 지분가치 재평가 논의 이후 발생할 수 있는 순환출자 구조 내 지분가치 재평가에 대한 적정가치를 반영.

현대차의 차세대 모빌리티 플랫폼 Mobed

자료: 유안타증권 리서치센터

현대위아 H-Motion의 주차로봇

자료: 유안타증권 리서치센터

백종민

방산/AI/로보틱스

02 3770 5598

jongmin.baik@yuantakorea.com

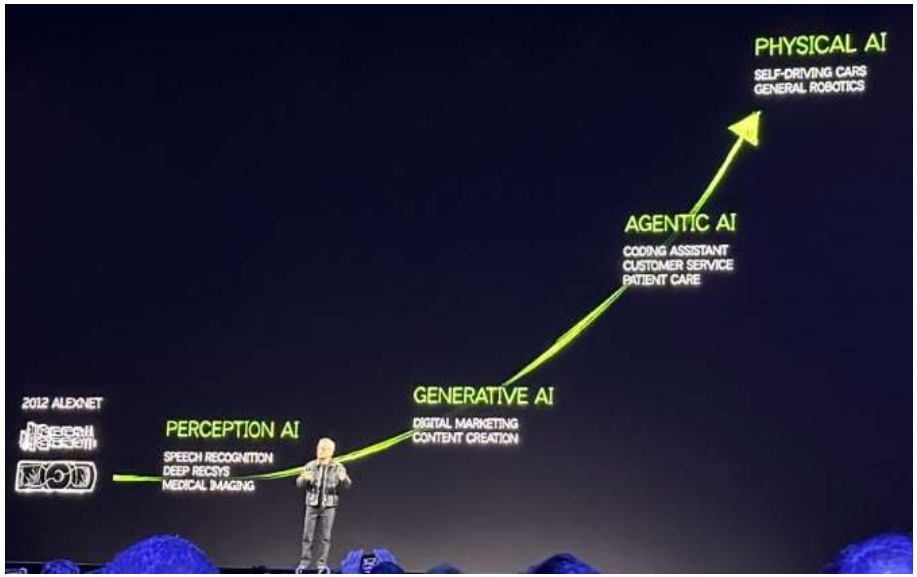
PART 4

꿈의 영역에서 상용화의 영역으로

로봇과 Physical AI, 꿈의 영역에서 상용화의 영역으로

- CES2026의 최대 화두는 단연코 로봇과 Physical AI
- 지난 CES2025에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 언급하며 **'개념'적으로 다뤄지던 Physical AI가 불과 1년 만에 '상용화' 단계**로 진입. 이번 행사의 기조 연설에서는 리사 수 AMD CEO가 세상 모든 것들이 AI를 기본 인프라로 작동될 미래를 전망. 특히 AI Agent의 발전을 강조하며, 로봇 및 Physical AI 상용화의 가속화를 예고
- CTA 공식 전시사 목록에 따르면 40개 이상의 기업이 휴머노이드 로봇을 언급. 실제로 행사장 곳곳에서 휴머노이드 로봇이 소개되면서 관람객들의 이목이 집중
- 한국에서는 현대차그룹의 보스턴다이내믹스가 '아틀라스'를 공개하며 구체적인 양산 계획을 발표했고, LG전자는 가정용 휴머노이드 'LG클로이드'를 공개
- 이 밖에도 휴머노이드는 아니지만 **Physical AI가 접목된 산업용 로봇 및 솔루션** 등이 공개. 휴머노이드와 달리 **당장 상용화 가능한 수준**을 시연했다고 평가되며, 이번 행사에서 선보인 제품의 출시 시기를 올해 상반기로 계획 중인 것으로 파악. Physical AI 기술이 의료·제조·스포츠 등 산업 및 일상을 변화시킬 것으로 전망

CES2025에서 젠슨 황 CEO가 강조한 Physical AI



자료: 엔비디아, 유안타증권 리서치센터

CES2026에서 기조 연설 중인 리사 수 AMD CEO

자료: 언론 종합, 유안타증권 리서치센터

로봇과 Physical AI, 개념의 영역에서 상용화의 영역으로

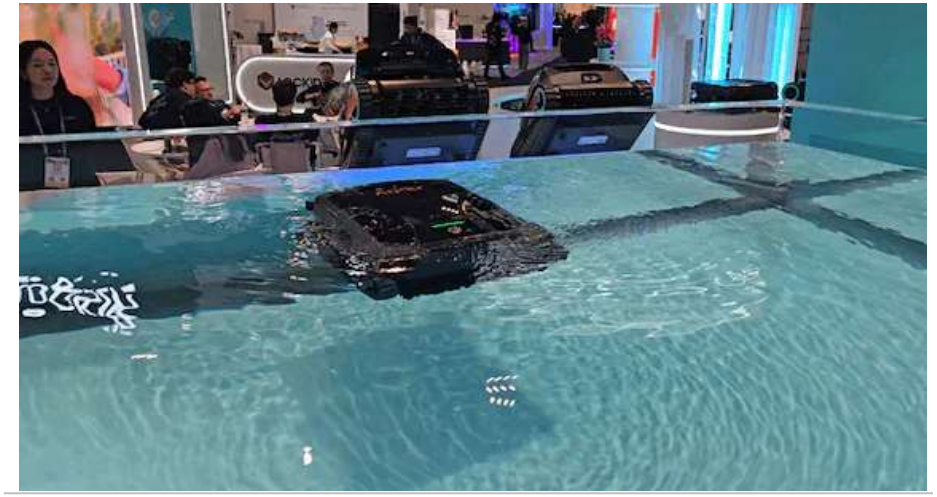
오시코시 코퍼레이션의 AI 로봇, 붐 리프트

자료: 유안타증권 리서치센터

센티젠트 테크놀로지의 야외용 동반 로봇 ROVER X3

자료: 유안타증권 리서치센터

아이퍼의 AI 기반 수영장 청소 로봇



자료: 유안타증권 리서치센터

톰봇의 강아지 로봇 제니

자료: 유안타증권 리서치센터

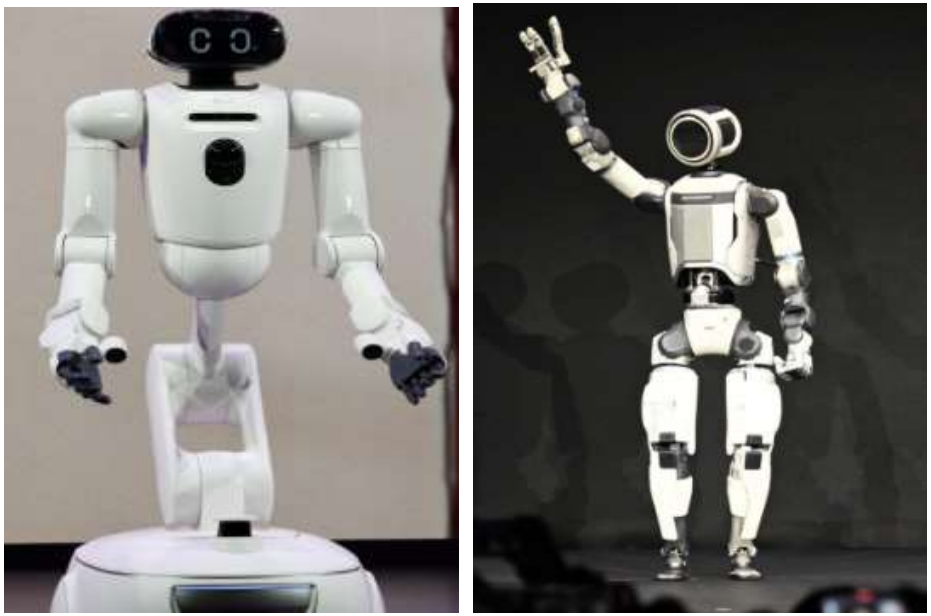
주인공은 단연코 휴머노이드, 그러나 갑론을박 여전

- 젠슨 황은 1년 이내 인간 수준의 로봇이 등장할 것으로 전망하며, 글로벌 인구 감소와 노동력 부족 문제를 AI와 로봇이 좋은 대안이 될 것이라고 언급
- 그러나, CES2026서 공개된 휴머노이드는 엔터테인먼트, 전시용에 가깝다며 일상에서 상용화되기까지 넘어야 할 **기술적 과제가 많다는 지적**이 존재
- 유니트리, AGIBOT 등 중국의 선두 휴머노이드 업체는 구체적인 용도와 특정 임무를 수행하기 위해 특화된 **SW 플랫폼 개발의 필요성**을 언급. 현재 양산 중인 로봇 대부분은 SW 연구기관에 납품되고 있는 것으로 파악. LG클로이드 역시 동작이 **굼뜨고 정해진 목적을 수행하지 못하는 모습**이 나타나는 등 기술적 한계 명확한 모습
- 현대차그룹은 아틀라스를 2028년부터 생산 거점에 투입한다고 발표. 초기에는 부품 분류 등 안전성과 품질 효과가 검증된 공정에 우선 적용되고, 2030년부터 부품 조립까지 작업 범위를 넓힐 계획. 지금까지 개발된 **휴머노이드는 상용화를 통한 ROI를 논하기보다, 차세대 버전을 위해 현장 데이터 확보 목적**이라는 판단
- 그럼에도, **기술 성장 속도는 주목할 필요**가 있다고 판단. 휴머노이드에 대한 갑론을박이 여전하지만, **AI Agent, 로봇 손, 촉각 센서 등 부속 기술들의 발전**과 개별 기업을 넘어 **국가적 역량이 투입**되는 산업인 만큼 시장의 예측보다 상용화 시기가 앞당겨질 가능성이 존재하기 때문

유니트리의 휴머노이드 G1, 아직까지는 엔터테인먼트 용에 가깝다는 평가

자료: 유안타증권 리서치센터

한국의 휴머노이드 로봇 (좌:LG클로이드, 우:아틀라스)

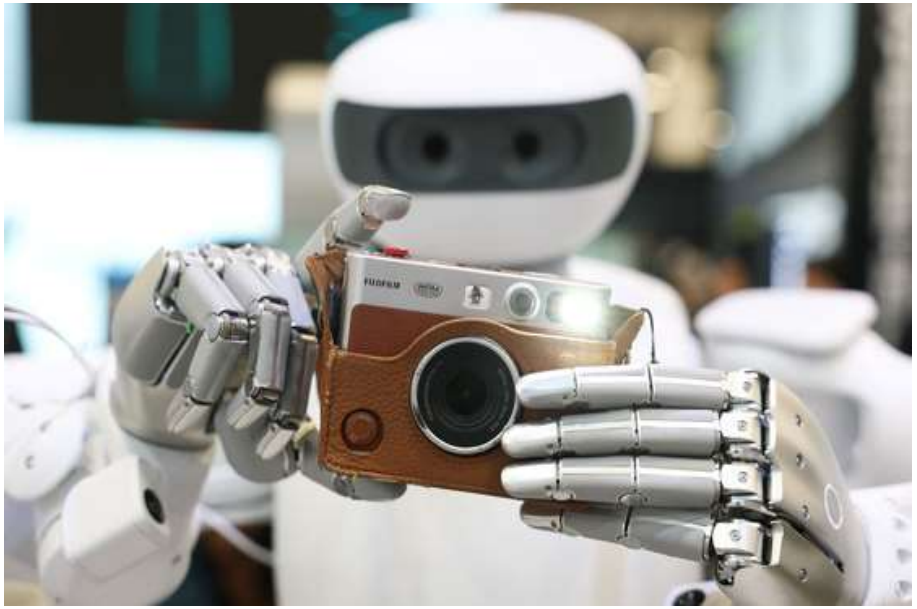


자료: 각 사, 유안타증권 리서치센터

휴머노이드와 더불어 '로봇 손' 분야 이목 집중

- CES2026에 참가하는 휴머노이드 기업은 34개. 완제품 시장 내 승자에 대한 불확실성 존재. 이들의 공통 분모인 로봇 손 등 핵심 밸류체인 기업에도 이목이 집중
- 최근 로봇 업계에서는 **민첩한 로봇 손의 진화가 주요 화두**. 공장 자동화를 위해 정밀 작업을 위한 로봇 손과 AI 프로세서, 가격 경쟁력을 가진 정밀 센서가 필수
- 일론 머스크는 **옵티머스 설계 최종 단계에서 로봇 손 개발의 난관**을 토로. HW 구현(사람 손 27~28개의 자유도 보유) 문제와 부품(액추에이터 등) 공급망 문제 언급
- CES2026에서 휴머노이드와 로봇 손이 핵심 이슈. 싱가포르의 샤르파가 로봇 분야 혁신상 수상, 한국의 만드로는 접근성 분야 혁신상 수상
- 테슬라의 옵티머스는 현재 11자유도 로봇 손 구현. **올해 공개 예정인 3세대 로봇은 22자유도의 로봇 손**을 탑재할 계획
- 이번 전시에서 한국의 로보티즈(108490), 원익로보틱스, 테솔로, 에이딘 로보틱스, 중국의 AGIBOT 등 다양한 회사들이 로봇 손 기술을 전시. **로보티즈는 20자유도, 원익로보틱스는 21자유도**, 테솔로는 20자유도, 에이딘로보틱스는 16자유도 로봇 손 공개. **중국의 선두 휴머노이드 업체 AGIBOT은 19자유도 손**을 탑재

사진 촬영 중인 싱가포르 샤르파의 휴머노이드



자료: 언론 종합, 유안타증권 리서치센터

로봇 손 분야 주요 기업 제품 개요

기업명	주요 제품	로봇 손 사양 및 경쟁력
로보티즈	HX5-D20	5손가락 20자유도(DoF) 구조. 자체 개발 소형 액추에이터 기반으로 정밀한 개별 관절 제어 구현. 손끝 9개의 택타일 센서로 물체 접촉 시 실시간 힘(Force) 제어 최적화
원익로보틱스	알레그로 핸드 L5	21자유도(DoF) 구조. 사람 손 대비 약 110% 크기로 유사한 운동 범위 구현. 1kg 미만 경량 설계를 통해 고속 동작 시 관성 최소화 및 응답 속도 극대화
테솔로 (Tesollo)	DG-5F-S	5손가락 20자유도(DoF) (손가락당 4개 독립 관절). 신형 모델 기준 무게 1kg 이하. 0.1g 단위 초미세 압력 감지 센서 융합 및 200만 회 이상 구동 내구성 검증
에이딘로보틱스	16-DoF Hand	기존 15자유도에서 **16자유도(DoF)**로 확장(엄지 관절 추가). 100채널 이상 고밀도 촉각 센서를 통해 손바닥·손가락 전체 압력 분포를 0.1mm 단위로 시각화 및 제어
애지봇 (Agibot)	OmniHand Pro	총 19자유도(DoF) (활성 DoF 12). Palm-up 기준 최대 35kg 하중 지지력 보유. 0.02mm의 높은 위치 반복 정밀도와 0.01N 수준의 미세 힘 변화 감지 역량
덱스로봇 (DexRobot)	DexHand 021	19자유도(DoF) 구조. 텐던(Tendon) 구동과 모터 직접 구동의 혼합 설계. 500개 이상 물리 접점 센서 포인트로 비정형 물체 파지 안정성 확보

자료: 유안타증권 리서치센터

K-Physical AI 산업의 중심, M.AX 얼라이언스

- M.AX(Manufacturing AI Transformation) 얼라이언스는 산업통상자원부가 추진하고 1,300여 개 주요 업체 및 기관이 참여한 민관 합동 연합체. M.AX는 한국 제조 산업 전반을 AI 기반으로 근본적으로 전환하겠다는 전략적 개념이나 국가 산업 전환을 상징하는 핵심 키워드
- CES2026에서는 M.AX 얼라이언스 내 40여개 기관이 공동전시관을 구성. **한국 휴머노이드 산업 전체의 구조와 전략**을 기술 전시가 아니라 현장 중심 실증 데모 중심으로 시연. 꼭 봐야할 **위협적인 로봇 부스라는 현장 평가**가 있었던 것으로 파악. 미·중 양강 구도 속 **K-휴머노이드 생태계 집단의 경쟁력**을 보여준 사례라는 판단
- 공동 전시관에 참여한 주요 상장 업체로 **로보티즈, 뉴로메카, 에스비비테크** 등이 있으며, 비상장 업체로는 에이로봇, 투모로로보틱스, 에이딘로보틱스, 블루로빈 등
- 산업부는 올해부터 반도체, 자동차, 로봇 등 분야별 AI 모델과 제품 개발이 본격 추진될 것이라고 강조. **AI 예산 중 최대 가용 금액은 7,000억원을 투입**할 계획
- 향후 한국이 휴머노이드 기술 경쟁을 넘어 글로벌 표준과 생태계 경쟁의 주도권을 확보하겠다는 목표 제시. 이번 행사는 K-휴머노이드 전략을 상징적으로 보여준 만큼 **관련 업체들에 대한 정책 수혜 기대**

M.AX 얼라이언스 공동 전시관 전경

자료: 유안타증권 리서치센터

휴머노이드 M.AX 얼라이언스 내 주요 참여 기관

자료: 유안타증권 리서치센터

M.AX 얼라이언스 내 주요 비상장 업체 로봇

투모로로보틱스, 레인보우로보틱스의 RB-Y1을 통해 기술 구현

자료: 유안타증권 리서치센터

에이딘로보틱스의 로봇 손

자료: 유안타증권 리서치센터

에이로봇, 휴머노이드 두 대가 협업하는 공정 시연

자료: 유안타증권 리서치센터

블루로빈, 휴머노이드 로봇 P-73

자료: 유안타증권 리서치센터

두산로보틱스(454910): Physical AI 시대, 두산그룹의 브레인

- 두산로보틱스가 CES2026서 첫 공개한 **'스캔앤고'는 AI 부문 최고혁신상과 로봇공학 부문 혁신상**을 수상하며 이목을 집중
- **'스캔앤고'**는 로봇팔과 자율이동로봇(AMR)이 결합된 플랫폼에 물리정보 기반 AI와 첨단 3D 비전을 적용한 산업용 AI 로봇 솔루션
  로봇팔 6개의 축에 장착된 토크센서를 통해 **①실시간 힘조절이 가능**하고, 별도의 설계도면을 제작할 필요가 없어 **②작업시간을 절약**
- **터빈 블레이드, 항공기 동체, 건물 외벽** 등 복합 구조물의 표면을 스캔해 최적의 작업 경로를 생성한 후 검사, 샌딩, 그라인딩 등의 작업을 수행
- 두산그룹은 작년 PAI(Physical AI) LAB을 신설하고 **전 사업부문 하드웨어의 지능화를 추진**. 한편 신년사를 통해 전사 역량 투입을 통한 AX 추진 의지를 표명
- 동사는 두산그룹의 피지컬AI 부문 SW 핵심 계열사로 **캡티브 시장을 통한 단기 성과 전망**. 검증된 솔루션은 글로벌 에너지, 건설, 항공 등 기업으로 확장 기대
- 이 밖에도 올해 산업 현장에 즉시 투입 가능한 AI 로봇을 공개한다고 발표. **현장 즉시 투입형 AI 로봇으로 수익성을 입증하겠다는 의지**라고 해석
- 이후 축적된 물리 데이터, 세부 기술 등을 통해 **차세대 범용 휴머노이드 시장 내 경쟁력을 확보**할 계획

두산로보틱스의 스캔앤고

자료: 유안타증권 리서치센터

Physical AI 시대, 두산로보틱스의 캡티브 시장 침투 시나리오

계열사	협업 내용 및 기대 효과
두산에너빌리티	'스캔앤고'를 활용한 터빈 블레이드 및 발전소 핵심 기기 검사/연마 자동화 위험 작업의 로봇 대체 및 유지보수 효율 극대화
두산밥캣	로보틱스의 AI 소프트웨어와 밥캣의 소형 장비를 결합한 '자율 작업 건설기계' 개발 북미/유럽 딜러망을 공유하여 로봇 판매 채널 확장
두산테스나	반도체 후공정 물류 자동화에 협동 로봇 및 AMR 솔루션 투입 가능성

자료: 유안타증권 리서치센터

로보티즈(108490): 로봇 손 분야의 절대 강자

- 로보티즈는 휴머노이드 로봇 'AI워커'와 5지 로봇 손 HX5-D20을 전시. **HX5-D20은 '올해 1월 공식 출시 예정, 출시 전부터 오픈AI, 구글, 애플 등에서 선주문 확보**
- 이번 전시에서 휴머노이드 플랫폼 AI워커에 로봇 손 HX5-D20을 장착하여 원격 작업을 시연. 작업자의 동작을 로봇에서 신속 정확하게 재현하며 이목이 집중
- 동사의 로봇 손은 손가락 관절마다 초소형 액추에이터를 심는 **'순수 모터' 방식**. 자체 개발한 손가락 전용 초소형 액추에이터 20개를 탑재해 **20자유도를 확보하면서도 내구성을 개선**. 테슬라의 옵티머스를 포함한 주요 업체들은 모터가 와이어를 당겨 손가락을 움직이는 **'케이블 드리븐' 방식. 단선과 유지보수 문제**가 걸림돌로 지적
- 또한 핵심 부품인 액추에이터부터 완제품까지 모두 내재화에 성공. **출시 예정인 로봇 손은 1,000만원 대**로 가격 경쟁력 확보. 경쟁사는 0.5~1억원 수준으로 파악
- 중국 손제작사들과 경쟁할 수 있는 수준의 가격대. **초소형 액추에이터는 원익로보틱스 등 주요 로봇 손 제조사**에 공급 중. 2028E 3만대 양산 계획 중인 **보스턴다이내믹스의 '뉴 아틀라스'**향 구동기도 최근 주문량이 늘어난 것으로 파악. 산업용 로봇손 시장 플레이어가 대부분 **동사의 생태계에 포함**
- 증가한 시장 수요 대응을 위해, 최근 412억원 규모 자사주 매각으로 자금을 확보. 최근 우즈벡 정부 산하 기업과 로봇 산업 시설 확장 구축을 위한 협력 진행

로보티즈의 'AI워커'와 로봇 손 'HX5-D20'

자료: 유안타증권 리서치센터

로보티즈 생태계 내 주요 기업

주요 기업/기관	협력 및 공급 내용
보스턴다이내믹스	차세대 휴머노이드 '뉴 아틀라스' 및 신형 로봇 핸드용 액추에이터 약 700여 개 공급
오픈AI	피지컬 AI 학습용 세미 휴머노이드 'AI 워커' 공급 및 하드웨어 개발 협력 논의 중
구글	로봇 제어 알고리즘(RT 시리즈) 연구용 표준 하드웨어로 다이나믹셀 대량 채택
LG전자	2대 주주로서 서비스 로봇 '클로이(CLOi)' 시리즈의 핵심 관절 부품으로 활용
현대자동차그룹	보스턴 다이내믹스-현대차-로보티즈로 이어지는 K-로봇 피지컬 AI 벨류체인 구축
원익로보틱스	산업용·연구용 고정밀 로봇 손 제작을 위한 소형 액추에이터 공급
테솔로	3지/5지 인간형 로봇 손 '델토 그리퍼'의 핵심 구동 모듈로 다이나믹셀 탑재
MIT / 스탠퍼드	'모바일 알로하(Mobile ALOHA)' 등 세계적인 AI 로봇 프로젝트의 표준 관절로 사용

자료: 언론종합, 유안타증권 리서치센터

에스비비테크(389500): 정밀 로봇 손을 위한 초소형 모듈 공개

- 에스비비테크는 하모닉 감속기를 국내 최초로 개발·양산해 국산화 성공한 업체. 감속기를 넘어 액추에이터 완제품까지 포트폴리오를 확장 중
- 이번 행사에서는 로봇 구동 관련 핵심 부품을 전시. ①하모닉 감속기, ②소형 액추에이터, ③조향·편심 구동기 등
- 전시 제품은 실제 로봇에 장착 가능한 형태로 구현. 동사의 부스에는 현대모비스 대표 및 글로벌 로봇 산업을 대표하는 주요 인사들이 방문했다고 발표. 이를 통해 휴머노이드 및 차세대 로봇 시장에서 요구되는 기술 조건과 향후 발전 방향에 대해 글로벌 기업들과 공통된 인사이트를 도출했다고 언급
- 로봇 손에 이목이 집중되는 가운데, 동사가 이번 전시에서 공개한 **정밀 로봇 손을 위한 초소형 액추에이터에 대한 관심도가 높았던 것으로 파악**
- **동사는 M.AX 얼라이언스 네트워크**를 통해 국내외 고객사로 핵심 부품 공급을 확대할 계획. 지난 10월에는 **현대자동차그룹** 로보틱스랩의 신개념 소형 모빌리티 플랫폼 MobED의 핵심 부품인 드라이브 앤 리프트 모듈(DnL 모듈) 내 **조향·편심 구동기 개발 협력**을 발표

에스비비테크의 로봇 손, 모빌리티 구동 관련 핵심 부품

자료: 유안타증권 리서치센터

에스비비테크의 액추에이터

자료: 유안타증권 리서치센터

기타 주요 핵심 부품 라인업

자료: 유안타증권 리서치센터

마음AI(377480): 보고 판단하고 행동하는 Physical AI 구현

- 마음AI는 AI Human 플랫폼으로 시작해 Physical AI 플랫폼으로 사업을 확장. 로봇, 차량, 가전 등 다양한 하드웨어에 통합이 가능한 엣지 AI 솔루션 전문 기업
- 동사는 CES2026 미디어데이에서 참여 기업 중 원픽(One Pick) 기업으로 선정되며 Physical AI 기술 경쟁력 공식 인정 획득
  미디어데이는 CES 개막에 앞서 전 세계 주요 언론과 애널리스트를 대상으로 반드시 주목해야할 핵심 기업과 기술을 CTA가 직접 선정해 소개하는 공식 프로그램
- 이번 행사에서 실제 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 Physical AI 실행 구조를 선보였음. 핵심은 MAIED(Maum AI Edge Device). MAIED는 로봇과 자율 시스템에 직접 탑재되어 현장에서 들어오는 시각, 음성, 센서 데이터를 즉시 인지하고 판단해 행동으로 연결하는 엣지 기반 AI 두뇌 장치. AI가 스스로 판단하고 실행하는 구조
- 전시 현장에서 중국 로봇 기업 유니트리의 로봇에 MAIED를 직접 부착한 시연 진행. 유니트리 측은 구체적인 기술 협업을 추진하자는 의사를 전달한 것으로 파악
- 이 밖에도 일부 해외 기업 등으로부터 실제 장비 구매 의사가 있었던 것으로 파악. 구동 장치 뿐 아니라 두뇌 장치에 대한 중요성도 부각되는 모습

미디어데이 원픽 기업에 선정된 마음AI

자료: CTA, 유안타증권 리서치센터

MAIED(Maum AI Edge Device) 개요

자료: 유안타증권 리서치센터

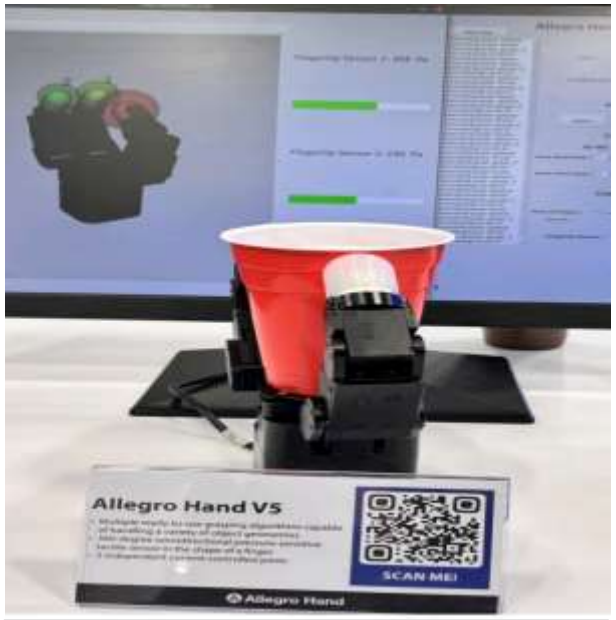
유니트리 로봇 개에 MAIED 부착해 시연 중

자료: 유안타증권 리서치센터

원익로보틱스: 엔비디아와 메타가 주목하는 로봇 손

- 원익로보틱스는 원익홀딩스(030530)의 자회사로 로봇 손, 서비스 로봇, AMR(자율주행로봇) 등의 로봇을 개발 및 공급 중. 주요 고객사로 원익 계열사와 삼성전자 등
- 동사는 이번 전시에서 '알레그로 핸드 L5 코어'를 선보였음. 양팔 로봇에 알레그로 핸드를 장착하여 물체를 집어 옮기는 데모 시연. 현재는 휴대폰에 스티커를 붙이는 수준의 공정 작업이 가능한 테스트 진행 중. 추후 실제 제조 공정에 투입할 계획
- **알레그로 핸드 L5 코어는 사람 손의 110% 크기에 21자유도**를 갖춰 정밀한 움직임이 가능하다는 평가. 또한 무게가 1kg 미만으로 **휴머노이드 로봇에 최적화**
- **글로벌 빅테크와의 협력 주목**할 필요. 미국은 제조업 재건과 첨단 산업 경쟁력 강화를 목표로 로봇과 자동화 기술에 대한 정책 지원 확대 기조 추세
- 동사는 **메타**와 촉각 센서 및 로봇 핸드 기술 공동 개발 중이며, **엔비디아**에는 로봇 손을 R&D 목적으로 공급 중. 엔비디아는 이번 행사에서 젯슨 토르 기반의 T4000 모듈과 산업용 엣지 AI를 위한 IGX 토르를 1월 말에 출시한다고 발표. 로봇 손이 연구개발을 넘어 **실제 현장 배치 시기**가 다가오는 중

원익로보틱스 로봇 손 라인업



자료: 유안타증권 리서치센터

원익로보틱스 로봇 손 라인업

자료: 유안타증권 리서치센터

양팔 로봇에 로봇 손을 장착하여 데모 시연 중

자료: 유안타증권 리서치센터

삼성전기 (009150) 투자등급 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	BUY	330,000	1년		
2026-01-06	BUY	330,000	1년		
2025-10-30	BUY	280,000	1년	-12.24	-2.86
2025-10-22	BUY	260,000	1년	-12.58	-10.77
2025-10-01	BUY	230,000	1년	-10.87	-6.09
2025-08-26	BUY	200,000	1년	-7.48	3.50
	담당자변경				
2024-09-05	BUY	190,000	1년	-33.68	-22.00
	담당자변경				

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

LG이노텍 (011070) 투자등급 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	BUY	330,000	1년		
2026-01-06	BUY	330,000	1년		
2025-10-31	BUY	280,000	1년	-6.87	5.18
2025-10-13	BUY	230,000	1년	-6.98	0.43
2025-08-26	BUY	200,000	1년	-11.16	-1.25
	담당자변경				
2024-10-24	BUY	260,000	1년	-39.36	-31.69
2024-09-05	BUY	320,000	1년	-32.83	-25.78
	담당자변경				

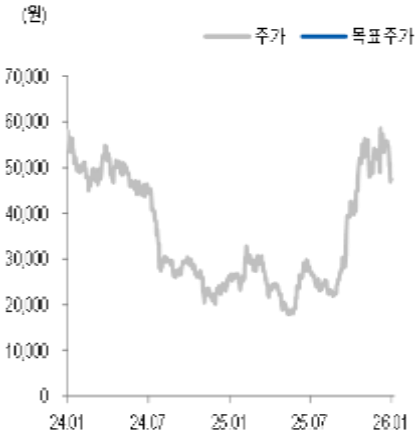
자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

LG전자 (066570) 투자등급 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	BUY	120,000	1년		
2026-01-06	BUY	120,000	1년		
2025-10-21	BUY	110,000	1년	-17.60	-9.36
2025-08-26	BUY	95,000	1년	-18.00	-4.21

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

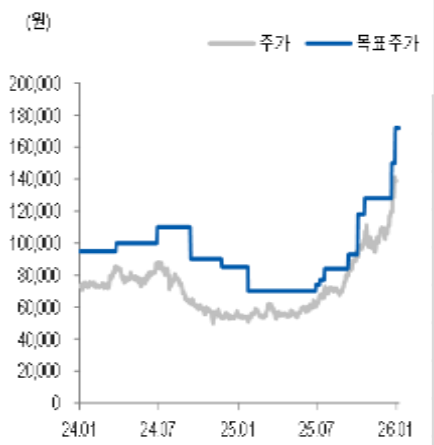
해성디에스 (195870) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	Not Rated	-	1년		
2025-12-24	Not Rated	-	1년		
	담당자변경				
2023-07-19	BUY	88,000	1년	-17.93	-12.50

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

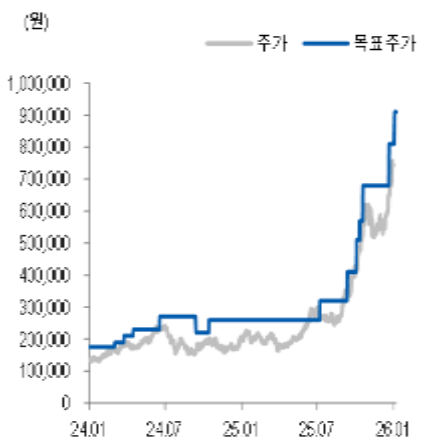
삼성전자 (005930) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	BUY	172,000	1년		
2026-01-08	BUY	172,000	1년		
2025-12-31	BUY	150,000	1년	-8.92	-6.00
2025-10-30	BUY	128,000	1년	-18.07	-6.33
2025-10-14	BUY	118,000	1년	-16.63	-13.56
2025-09-22	BUY	93,000	1년	-6.42	1.51
2025-07-29	BUY	84,000	1년	-14.52	-4.17
2025-07-18	BUY	77,000	1년	-12.88	-8.57
2025-07-09	BUY	74,000	1년	-14.14	-9.86
2024-09-23	BUY	90,000	1년	-35.64	-28.11

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

SK하이닉스 (000660) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	BUY	910,000	1년		
2025-12-31	BUY	810,000	1년	-10.68	-6.67
2025-10-29	BUY	680,000	1년	-16.07	-4.26
2025-10-22	BUY	570,000	1년	-10.33	-6.14
2025-10-14	BUY	510,000	1년	-9.61	-4.80
2025-09-22	BUY	410,000	1년	-9.60	4.39
2025-07-18	BUY	320,000	1년	-13.38	10.31
2024-10-25	BUY	260,000	1년	-21.49	15.38
2024-09-23	BUY	220,000	1년	-16.54	-9.91
2024-04-04	BUY	210,000	1년	-14.38	-10.29

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

현대차 (005380) 투자등급 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	BUY	430,000	1년		
2026-01-06	BUY	370,000	1년	-4.77	-1.08
2025-10-31	BUY	320,000	1년	-12.47	-1.41
2025-09-02	BUY	300,000	1년	-23.76	-11.67
2025-09-01	BUY	380,000	1년		
	담당자변경				
2025-08-29	1년 경과 이후		1년		-100.00
2024-08-29	BUY	380,000	1년	-44.66	-31.84
2024-07-04	BUY	350,000	1년	-27.11	-19.14

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

현대모비스 (012330) 투자등급 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	BUY	490,000	1년		
2026-01-06	BUY	450,000	1년	-12.37	-11.22
2025-09-02	BUY	410,000	1년	-22.16	-7.93
	담당자변경				
2025-05-15	BUY	360,000	1년	-30.75	-26.94
	담당자변경				
2025-01-31	BUY	360,000	1년		
2024-10-30	1년 경과 이후		1년	-14.54	-9.14
2023-10-30	BUY	290,000	1년	-20.85	-7.24

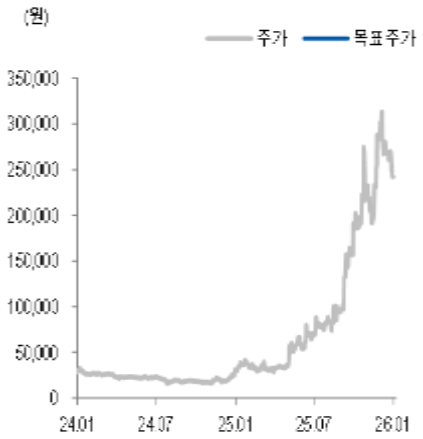
자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

두산로보틱스 (454910) 투자등급 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	Not Rated	-	1년		
	담당자변경				
2025-03-25	1년 경과 이후		1년		
2024-03-25	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

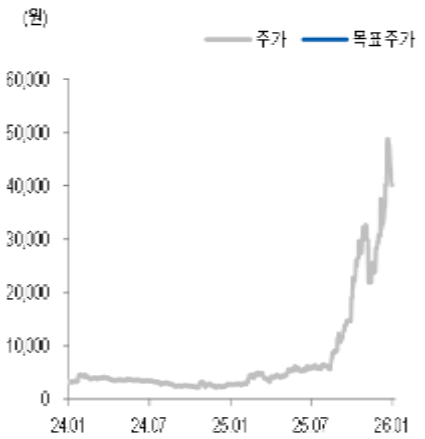
로보티즈 (108490) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	Not Rated	-	1년		
	담당자변경				
2024-01-25	1년 경과 이후		1년		
2023-01-25	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

원익홀딩스 (030530) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	Not Rated	-	1년		

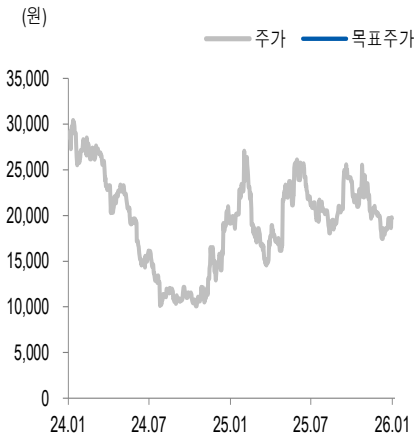
자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

에스비비테크 (389500) 투자등급 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권
주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100
* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"
2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

마음AI (377480) 투자등급 및 목표주가 추이



일자	투자 의견	목표가 (원)	목표가격 대상시점	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
2026-01-12	Not Rated	-	1년		

자료: 유안타증권

주: 괴리율 = (실제주가* - 목표주가) / 목표주가 X 100

* 1) 목표주가 제시 대상시점까지의 "평균주가"

2) 목표주가 제시 대상시점가지의 "최고(또는 최저) 주가"

구분	투자의견 비율 (%)
Strong Buy(매수)	0
Buy(매수)	94.2
Hold(중립)	5.8
Sell(비중축소)	0
합계	100.0

주: 기준일 2026-01-11

※해외 계열회사 등이 작성하거나 공표한 리포트는 투자등급 비율 산정시 제외

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함.
  (작성자: 고선영, 백길현, 김용민, 백종민)
- 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다.
- 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료공표일 현재 대상법인의 주식관련 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 종목 투자등급 (Guide Line): 투자기간 6~12개월, 절대수익률 기준 투자등급 4단계(Strong Buy, Buy, Hold, Sell)로 구분한다
- Strong Buy: +30%이상 Buy: 15%이상, Hold: -15% 미만 ~ +15% 미만, Sell: -15%이하로 구분
- 업종 투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분
- 2014년 2월21일부터 당사 투자등급이 기존 3단계 + 2단계에서 4단계로 변경

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.

유안타증권 Yuanta Securities (Korea)

Head of Research Center 최현재
3770-2553 / hyunjae.choi@yuantakorea.com

부센터장 2차전지/신에너지 이안나
3770-5599 / anna.lee@yuantakorea.com

투자전략

팀장 Strategist	김용구	3770-3521	yg.kim@yuantakorea.com
Fixed Income Strategist	이재형	5579	jaehyung.lee@yuantakorea.com
Global Strategist	민병규	3635	byungkyu.min@yuantakorea.com
Passive/ETF Analyst	고경범	3625	gyeongbeom.ko@yuantakorea.com
Economist/ESG	김호정	3630	hojung.kim@yuantakorea.com
US Market Analyst	황병준	3523	byeongjun.hwang@yuantakorea.com
Quant Analyst	신현용	3634	hyunyong.shin@yuantakorea.com
Research Assistant	임지윤	3527	jiyoon.lim@yuantakorea.com
Research Assistant	김혜원	3526	hyewon.kim@yuantakorea.com
Research Assistant	김세빈	3646	sebin2.kim@yuantakorea.com

기업분석

팀장 2차전지/신에너지	이안나	3770-5599	anna.lee@yuantakorea.com
인터넷/SW	이창영	5596	changyoung.lee@yuantakorea.com
정유/화학	황규원	5607	kyuwon.hwang@yuantakorea.com
스몰캡	권명준	5587	myoungchun.kwon@yuantakorea.com
철강/비철금속	이현수	5718	hyunsoo.yi@yuantakorea.com
화장품/의료기기/유통	이승은	5588	seungeun.lee@yuantakorea.com
제약/바이오	하현수	2688	hyunsoo.ha@yuantakorea.com
통신/지주	이승웅	5597	seungwoong.lee@yuantakorea.com
조선/자동차	김용민	5606	yongmin.kim@yuantakorea.com
미디어/엔터/디지털자산	이환욱	5590	hwanwook.lee@yuantakorea.com
전력기기/음식료	손현정	5595	hyunjeong.son @yuantakorea.com
반도체	백길현	5635	gilhyun.baik@yuantakorea.com
금융	우도형	5589	dohyeong.woo@yuantakorea.com
전기전자	고선영	3525	sunyoung.kou@yuantakorea.com
방산/AI/로보틱스	백종민	5598	jongmin.baik@yuantakorea.com
운송	최지운	3640	jiyun.choi@yuantakorea.com
Research Assistant	김도엽	5580	doyub.kim@yuantakorea.com
Research Assistant	서석준	5585	seokjun.seo@yuantakorea.com
Research Assistant	한동우	3647	dongwoo.han@yuantakorea.com
Research Assistant	임석민	3648	seokmin.lim@yuantakorea.com
Research Assistant	김고은	3649	koeun2.kim@yuantakorea.com
Research Assistant	배종성	3643	jongsung.bae@yuantakorea.com
Research Assistant	신승우	5594	sungwoo.shin@yuantakorea.com

유안타증권
Yuanta Securities (Korea)